



The Solution SoC Company

2025年度 第3四半期 決算概要

2026年1月30日
株式会社ソシオネクスト

本資料は、株式会社ソシオネクスト（以下「当社」といいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国又はそれ以外の一切の法域における有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。米国、日本国又はそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出又はこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を行うことはできません。

本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性及び完全性に依拠し、前提としていますが、その真実性、正確性又は完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。本資料の使用又は内容等に関して生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開又は利用することはできません。本資料には、当社に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」というような表現や将来の事業活動、業績、出来事又は状況を説明するその他の類似した表現が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基に、本資料の作成時点における当社の経営陣の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提（仮定）の下になされています。そのため、これらの将来に関する記述又は前提（仮定）は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。したがって、これらの将来に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。なお、本資料に記載された情報は本資料の日付（又はそこに別途明記された日付）時点のものであり、新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社は負いません。

商談獲得金額及び商談獲得残高に関する注意事項

商談獲得金額及び商談獲得残高の算出には、当社による将来の予測や主観的判断が相当程度考慮されています。これらの予測や主観的判断には、量産される製品の販売全期間及び受注が中止される可能性に関する見込みの他、開発計画、開発コスト、NRE売上、製品単価及び将来の製品の販売数量に関する仮定及び見込みが含まれます。製品の販売数量は、顧客から提示された初期的な数量見込みの他、顧客との過去の取引履歴に基づく当社独自の予測、第三者による市場データその他の情報を基礎として判断したものですが、製造委託先の受注制限など製造キャパシティによる制約は考慮していません。売上高の分析や商談獲得残高を定める際、当社は、それぞれの顧客需要が、短期的な在庫の積み増しによる特需、又は、足許の潜在的な需要を反映しない他の活動による特需に該当するかどうかを考慮しています。当社は、それぞれの顧客需要が特需に該当するかどうかは、当該需要に関連するさまざまな要因を考慮して、当社独自の判断に基づいて、案件毎に決定しています。よって、当社が特需であると判断する金額が、この資料において当社が特需とは何かを説明している定義に必ずしも当てはまらない場合があります。当社は、商談獲得金額を長期的な売上傾向を評価、分析するための指標として活用することを意図しているため、特需は当社商談獲得残高から除くことが適当であると考えています。特需に起因する当社の売上高は、長期的な需要の前倒しに伴い短期的に膨らんだ需要とみられるべきであり、これら売上高は、当社の過去業績推移や将来トレンドを分析する上で、重視されないことが適切であると考えています。なお、商談獲得残高は特需の有無やその金額の大小には影響されない一方、特需以外の需要に関する予測前提の変化を反映し変動します。当社は将来、商談獲得金額の算出方法を変更する可能性があり、また、過去にも変更しています。それゆえ、期間毎の直接的な比較は、中長期的なトレンドを示す以上の意味を有しない可能性があります。商談獲得に関する情報は、当社の管理会計に基づき算出され、経営陣による業績の評価及び戦略・計画の立案のために内部的に作成されているものです。当社は新しいビジネスモデルの下では限定的な期間しか事業を行ってきておらず、かつ、当社の事業では商談獲得から製品売上の計上までの期間が長いため、当社の事業及び将来の見通しを評価するための財務情報は限定的であり、当社の過年度の業績は今後の業績を判断する情報としては不十分である可能性があります。本資料ではあくまで参考情報として商談獲得に関する情報を記載しています。したがって、本資料に記載された商談獲得に関する情報について、過度に依拠することのないようご注意ください。将来情報に関するリスクについては、P2をご参照ください。

socionext™

The Solution SoC Company

2025年度第3四半期連結決算

- 2025年度第3四半期連結決算概要
- 2025年度通期予想



2025年度第3四半期 損益計算書

	2024年度				2025年度			前年同期比		(単位：億円)	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	増減率	増減率	前期比	増減率
売上高	528	464	461	433	346	527	549	+88	+19.2%	+23	+4.3%
製品売上	423	377	350	316	259	445	443	+93	+26.4%	-2	-0.4%
NRE売上	103	84	108	114	85	80	104	-4	-3.7%	+25	+30.9%
その他	2	3	2	3	2	2	2	0	-6.1%	0	-10.6%
売上原価	229	222	206	188	144	309	311	+105	+50.9%	+2	+0.8%
製品売上原価率	54.3%	59.1%	58.8%	59.6%	55.6%	69.4%	70.2%	+11.4pt		+0.8pt	
販売費及び一般管理費	196	189	204	201	187	195	204	0	+0.1%	+9	+4.8%
研究開発費	150	138	156	154	142	147	153	-4	-2.4%	+5	+3.6%
販売費・管理費	46	51	47	47	45	47	51	+4	+8.4%	+4	+8.4%
営業利益	103	53	51	43	14	23	34	-17	-32.7%	+11	+47.7%
営業利益率	19.4%	11.4%	11.1%	10.0%	4.2%	4.4%	6.3%	-4.8pt		+1.9pt	
当期純利益	76	40	49	31	5	16	27	-22	-44.3%	+11	+70.6%
純利益率	14.3%	8.6%	10.6%	7.2%	1.3%	3.0%	5.0%	-5.6pt		+2.0pt	
為替レート (USD/JPY)	155.9	149.4	152.4	152.6	144.6	147.5	154.2	+1.8		+6.7	

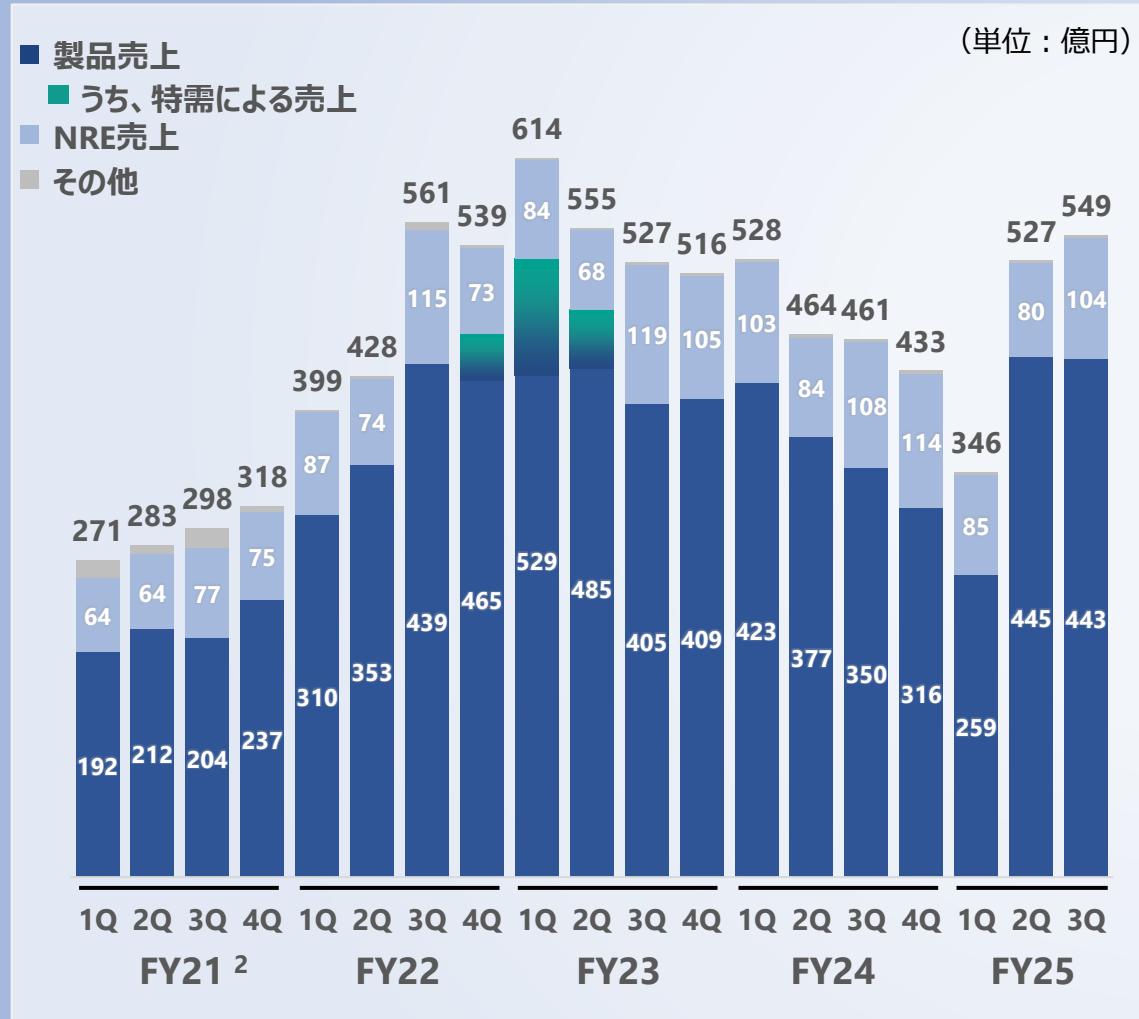
2025年度第3四半期累計 損益計算書

(単位：億円)

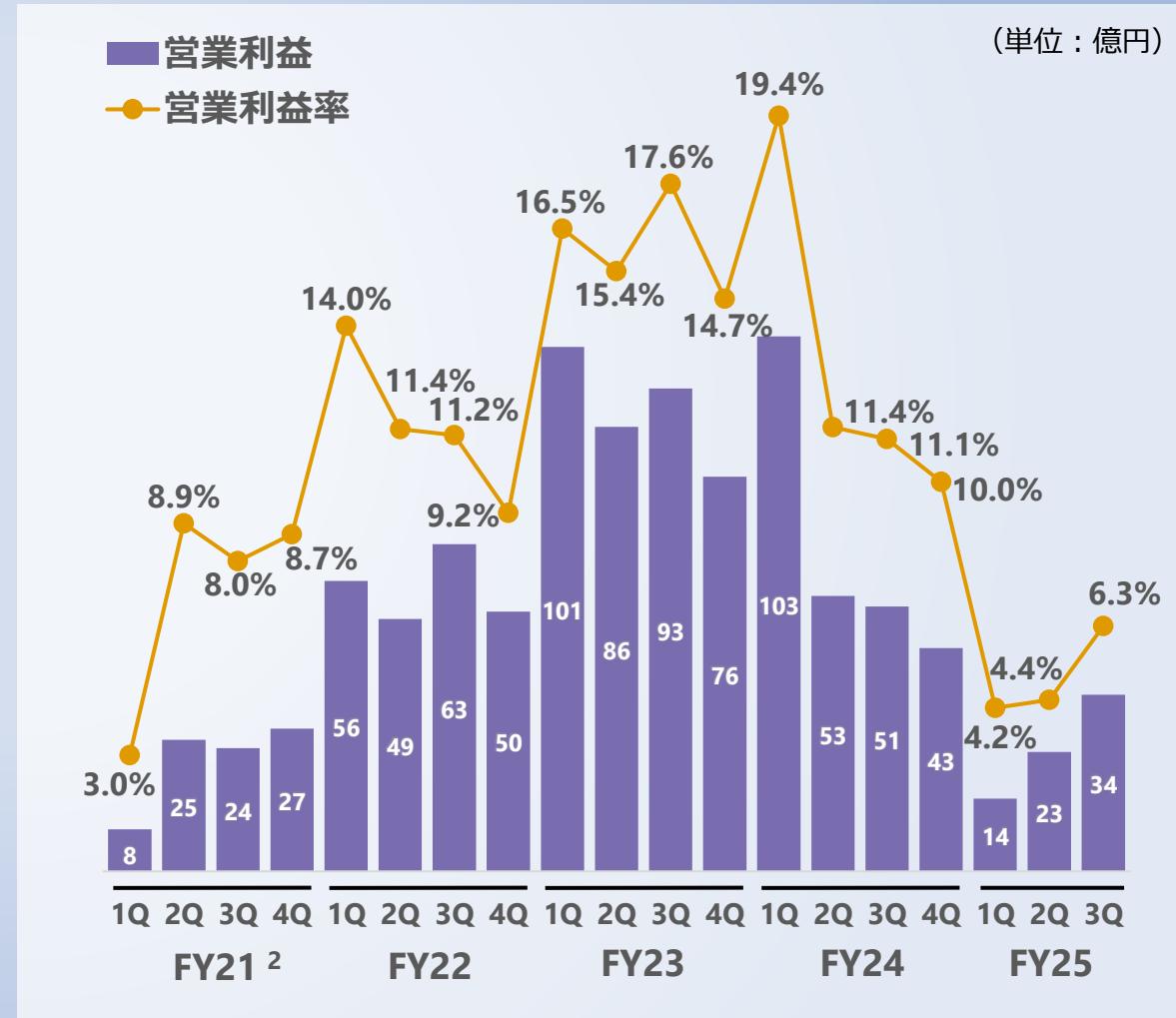
	2024年度		2025年度		前年同期比	増減率
	1-3Q		1-3Q			
売上高	1,453		1,421		-31	-2.2%
製品売上	1,150		1,147		-3	-0.3%
NRE売上	296		269		-27	-9.2%
その他	7		6		-1	-9.1%
売上原価	658		764		+106	+16.1%
製品売上原価率	57.2%		66.6%		+9.4pt	
販売費及び一般管理費	588		586		-2	-0.4%
研究開発費	444		442		-2	-0.4%
販売費・管理費	144		143		-1	-0.4%
営業利益	207		72		-135	-65.1%
営業利益率	14.2%		5.1%		-9.1pt	
当期純利益	165		48		-117	-71.0%
純利益率	11.3%		3.4%		-7.9pt	
為替レート (USD/JPY)	152.6		148.7		-3.9	

四半期別の売上高及び営業利益の推移

売上高¹



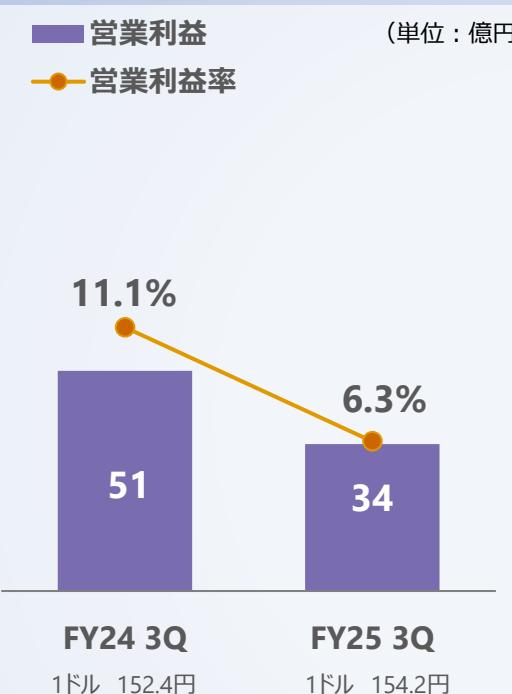
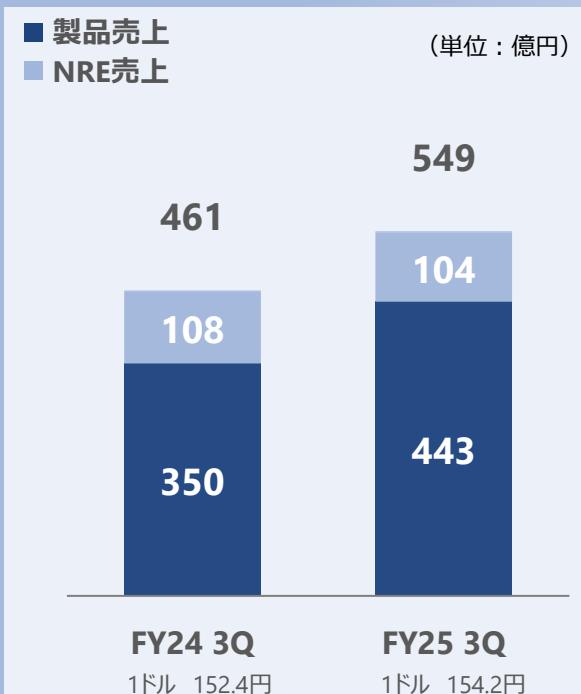
営業利益¹



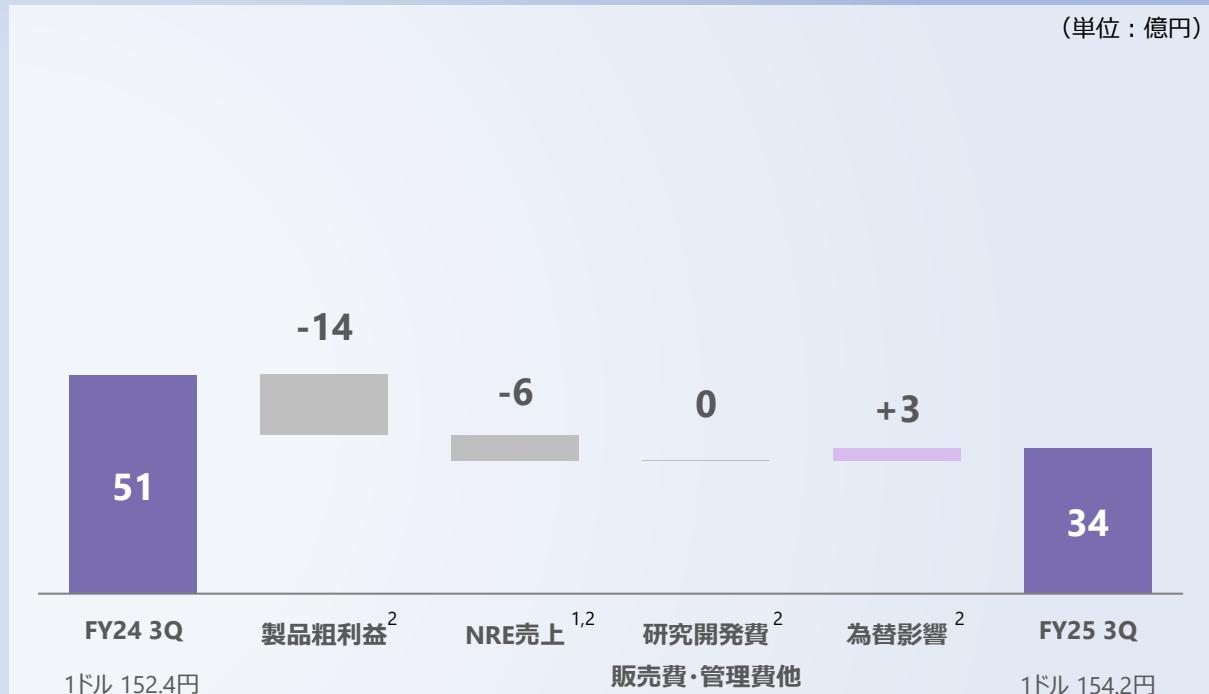
1. 四半期における数値は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

2. 2021年度の四半期の数値については、監査法人による監査及びレビューを行っておりません。

売上高、営業利益 前年同期比



営業利益 前年同期比の変動内容



<売上高> 前年同期比 +88億円 (+19.2%)

- 製品売上 +93億円 (うち、為替影響 +5億円)
- NRE売上 -4億円 (うち、為替影響 +2億円)
(1ドル152.4円→154.2円)

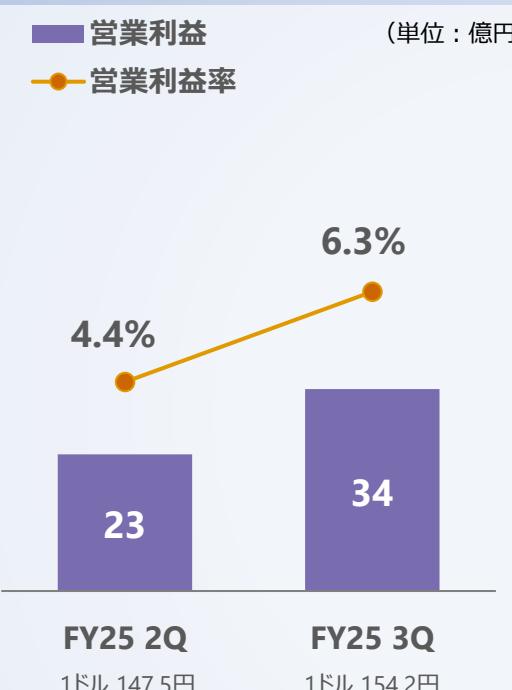
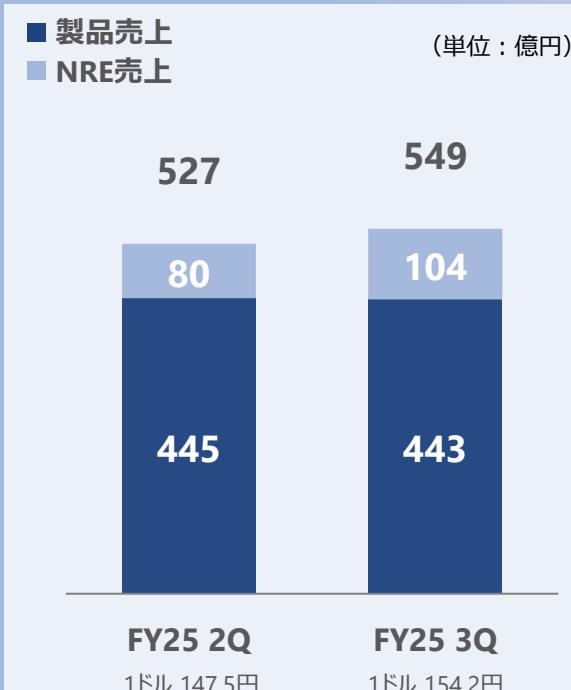
<営業利益> 前年同期比 -17億円 (-32.7%)

- 製品粗利益減 -14億円
- NRE売上減 -6億円
- 研究開発費・販管費増他 0億円
- 円安による為替影響 +3億円 (1ドル152.4円→154.2円)

1. NRE売上に関する研究開発費は費用として計上されます。したがって、NRE売上の全額が営業利益に寄与するわけではありません。

2. 為替影響は前年同期比又は前四半期比での為替レートの変動によるものです。営業利益の変動内訳に表記されている数値は為替影響を除いた数値となります。

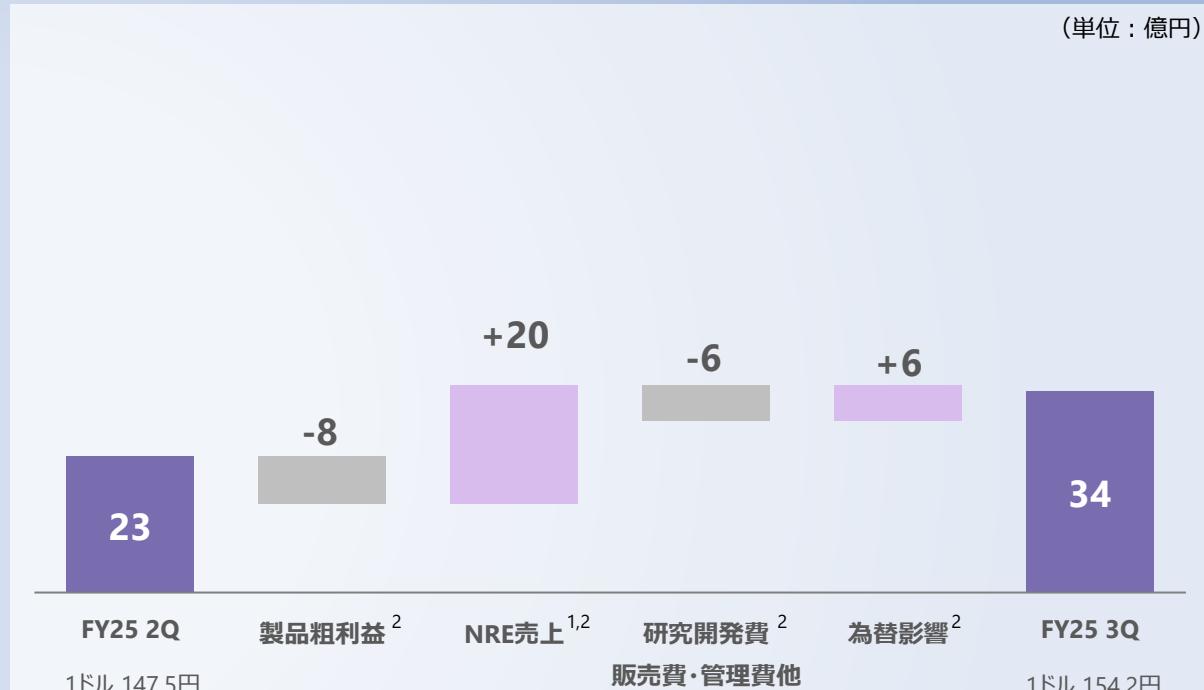
売上高、営業利益 前四半期比



<売上高> 前四半期比 +23億円 (+4.3%)

- 製品売上 -2億円 (うち、為替影響 +16億円)
- NRE売上 +25億円 (うち、為替影響 +5億円)
(1ドル147.5円→154.2円)

営業利益 前四半期比の変動内容



<営業利益> 前四半期比 +11億円 (+47.7%)

- 製品粗利益減 -8億円
- NRE売上増 +20億円
- 研究開発費・販管費増他 -6億円
- 円安による為替影響 +6億円 (1ドル147.5円→154.2円)

1. NRE売上に関する研究開発費は費用として計上されます。したがって、NRE売上の全額が営業利益に寄与するわけではありません。

2. 為替影響は前年同期比又は前四半期比での為替レートの変動によるものです。営業利益の変動内訳に表記されている数値は為替影響を除いた数値となります。

連結貸借対照表（2025年12月末時点）

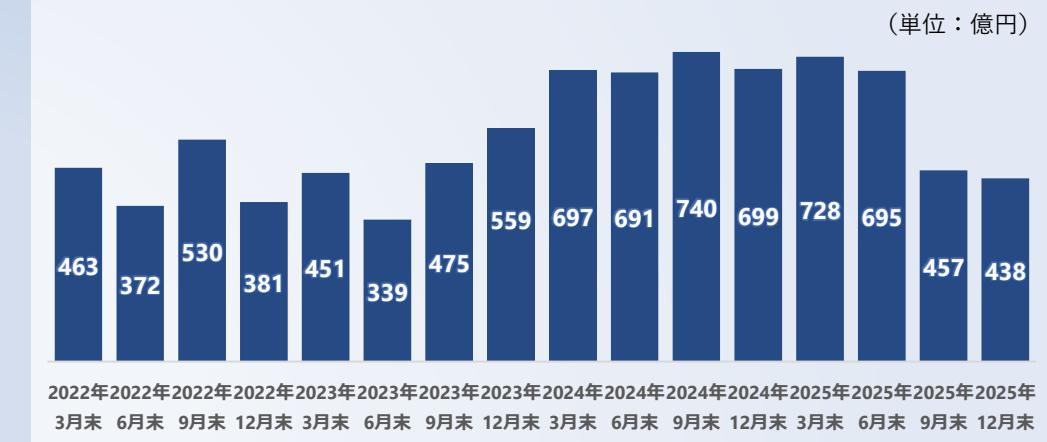
	2025年 3月末	2025年 12月末	前年度末比
資産			(単位：億円)
流動資産			
現預金¹	1,703	1,633	-70
売掛金	1,263	1,176	-87
棚卸資産²	728	438	-290
未収入金	316	326	+10
固定資産	170	328	+157
440	457	+17	
負債			
流動負債	333	344	+11
買掛金	313	323	+10
未払金	119	158	+38
46	35	-11	
純資産	1,370	1,289	-81
自己資本比率	80.5%	78.9%	

1. 現預金には短期保有有価証券を含みます。

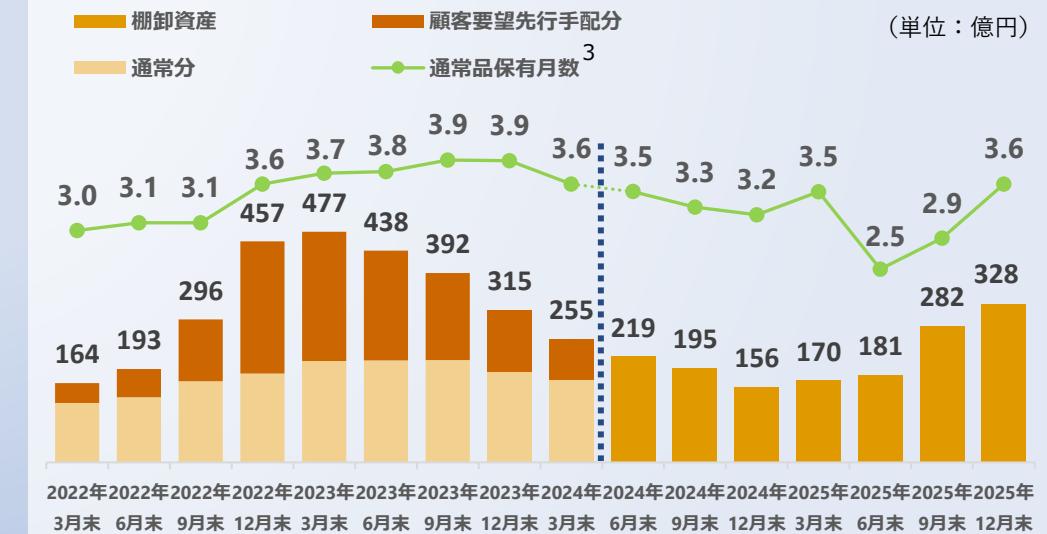
2. 棚卸資産は製品と仕掛品の合計です。

3. 通常品保有月数 = 通常品棚卸資産金額 ÷ 次期3ヵ月平均の製品原価金額見通し

現預金残高¹



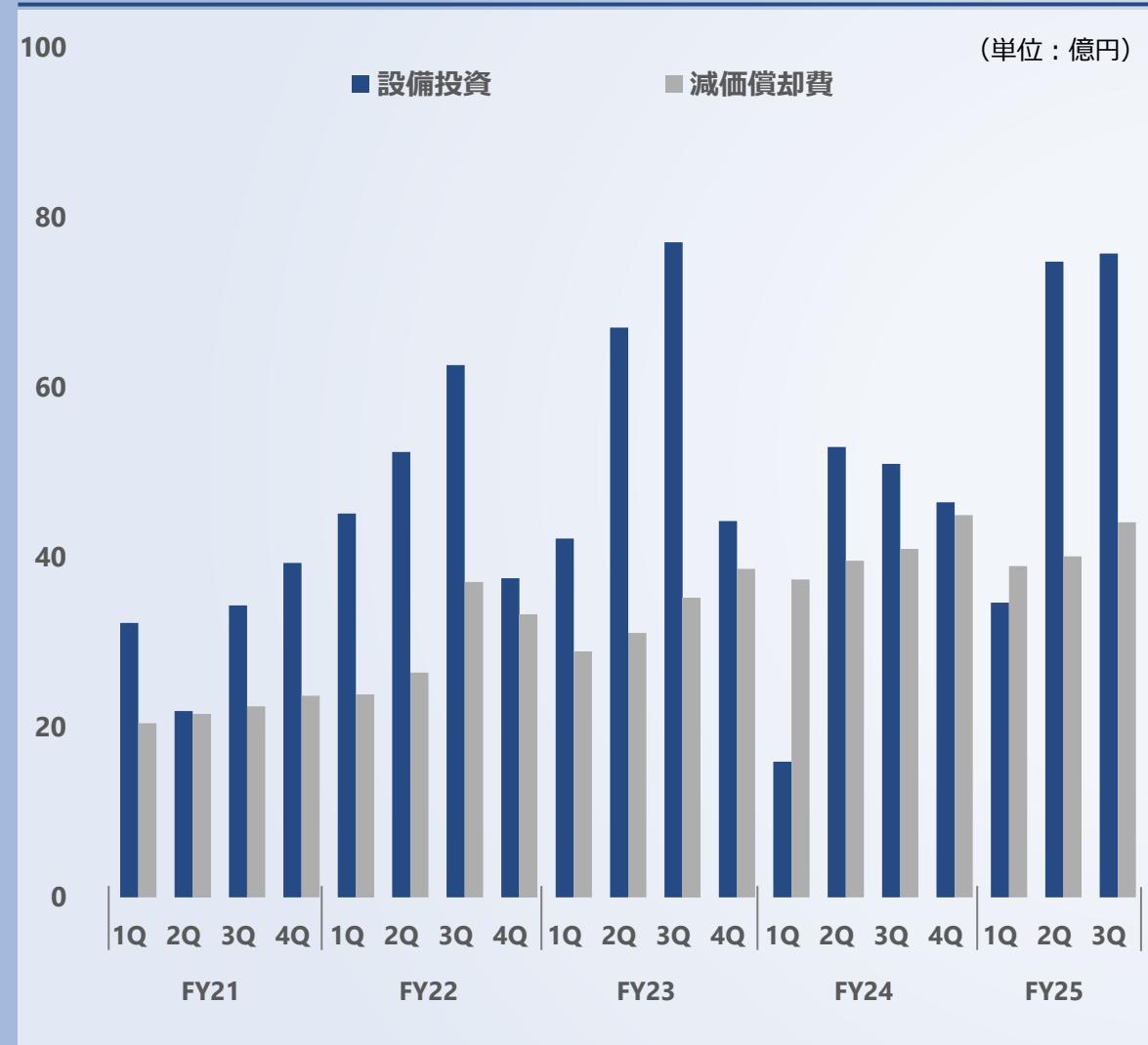
棚卸資産残高²



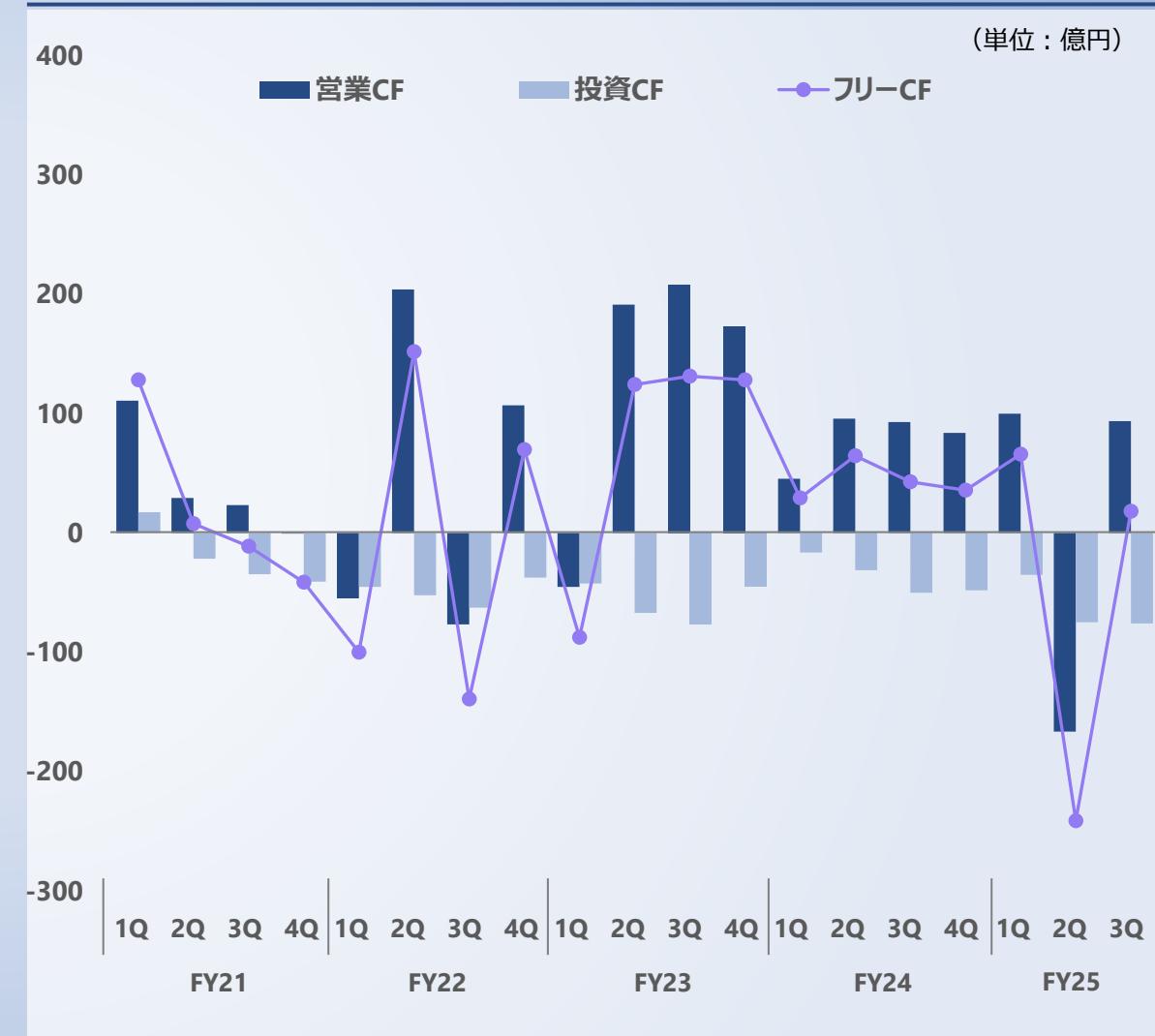
* 2024年度より顧客要望先行手配分と通常分を合計し、棚卸資産として開示しています。

設備投資 減価償却費 / キャッシュフロー

設備投資¹-減価償却費²



キャッシュフロー²



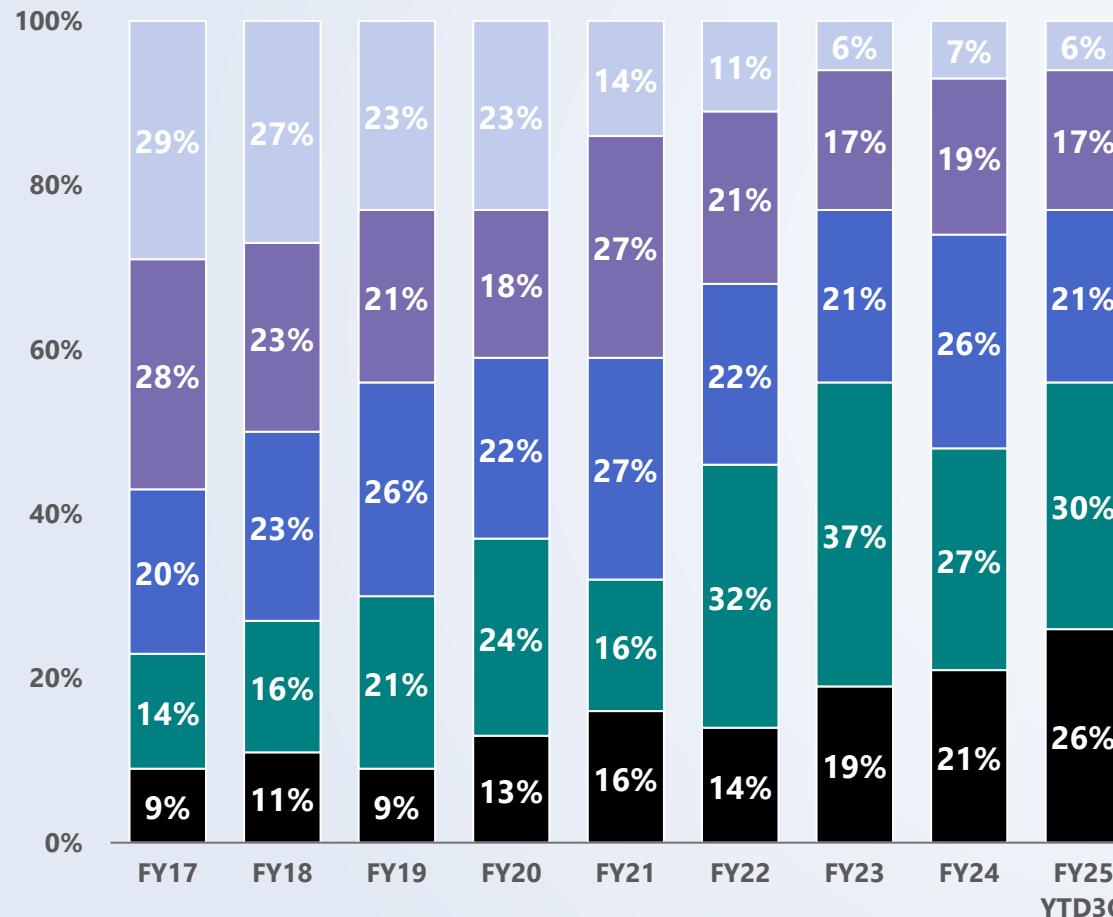
1. 設備投資=有形固定資産の取得による支出+無形固定資産の取得による支出

2. 2021年度の四半期の数値については、監査法人による監査及びレビューを行っていません。

売上の内訳（アプリケーション別）

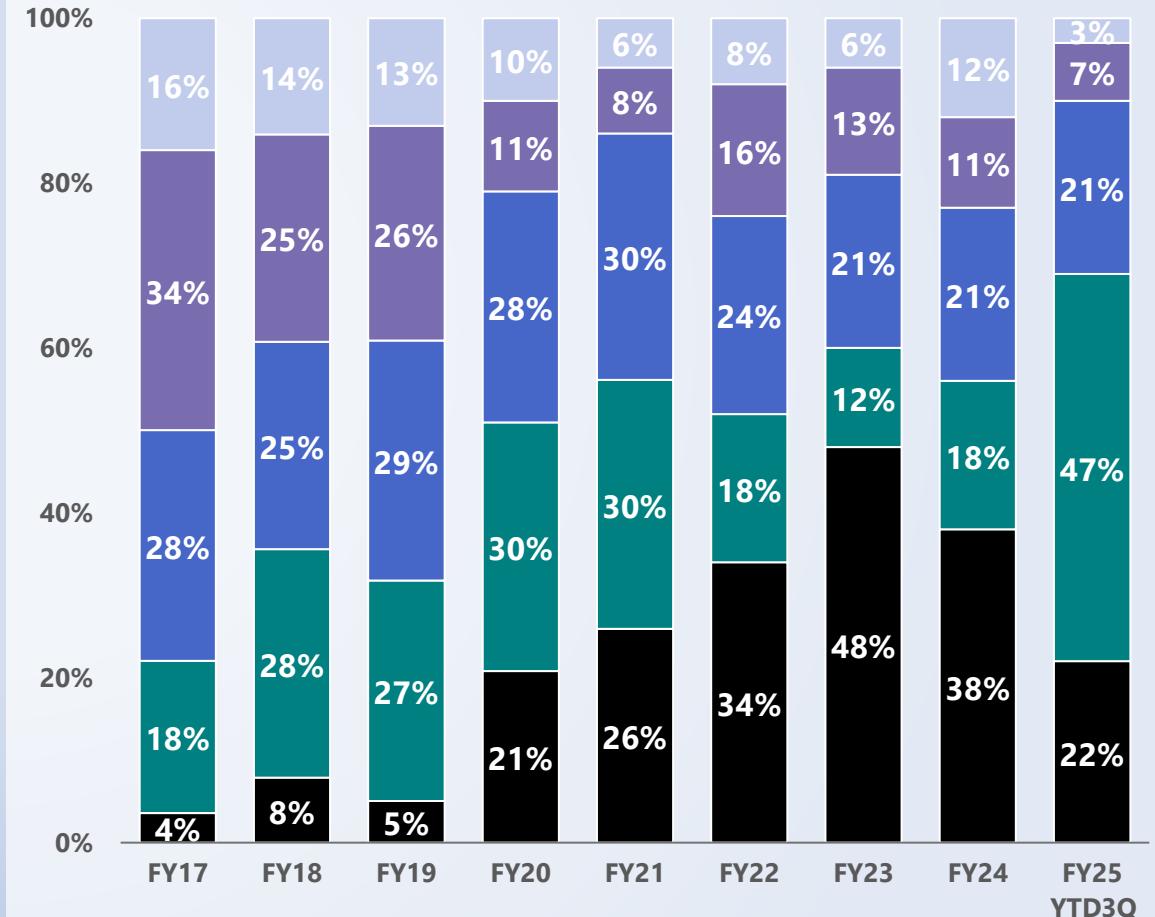
売上高

■ オートモーティブ ■ データセンター/ネットワーク ■ スマートデバイス ■ インダストリアル ■ その他

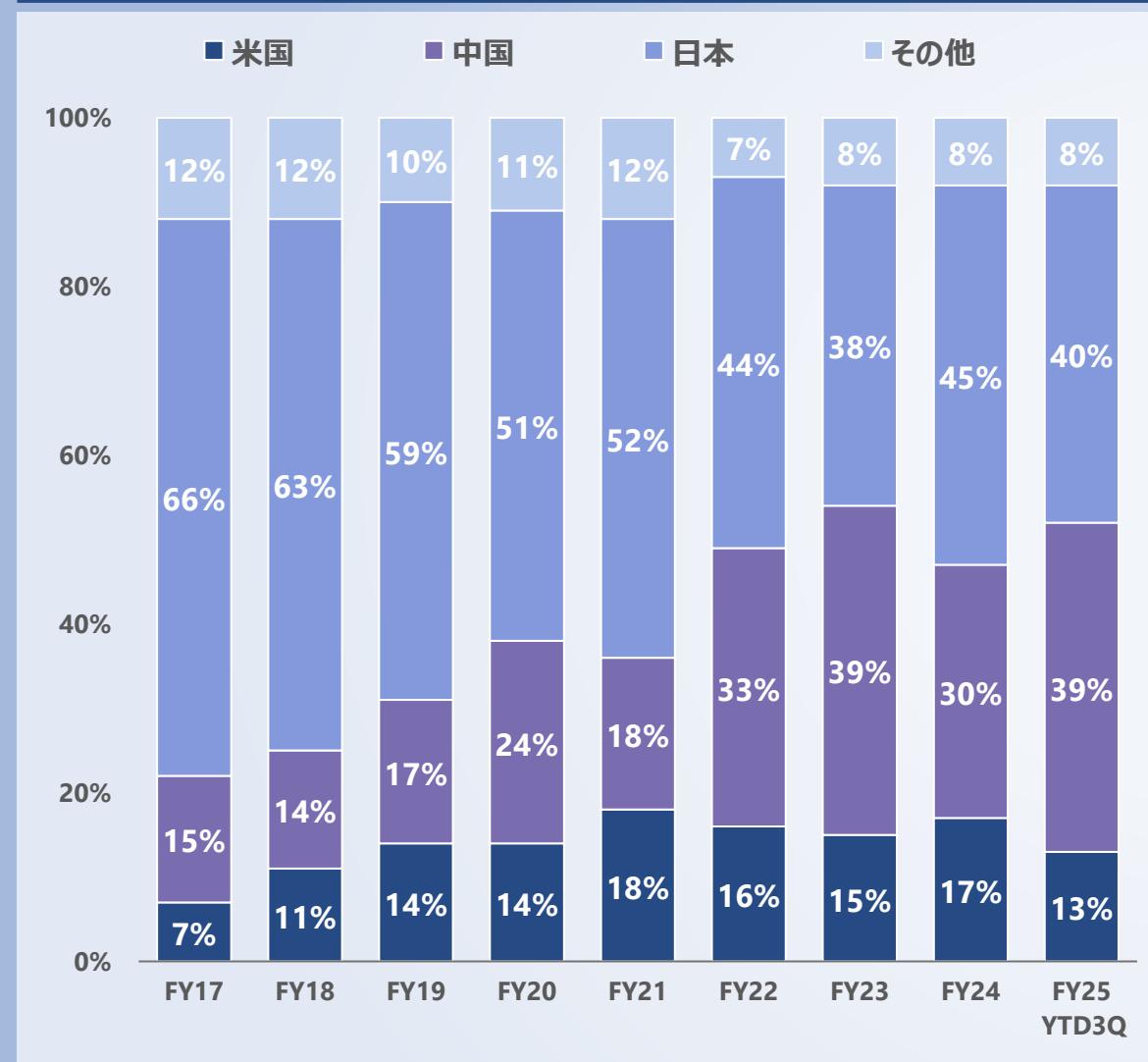


NRE売上

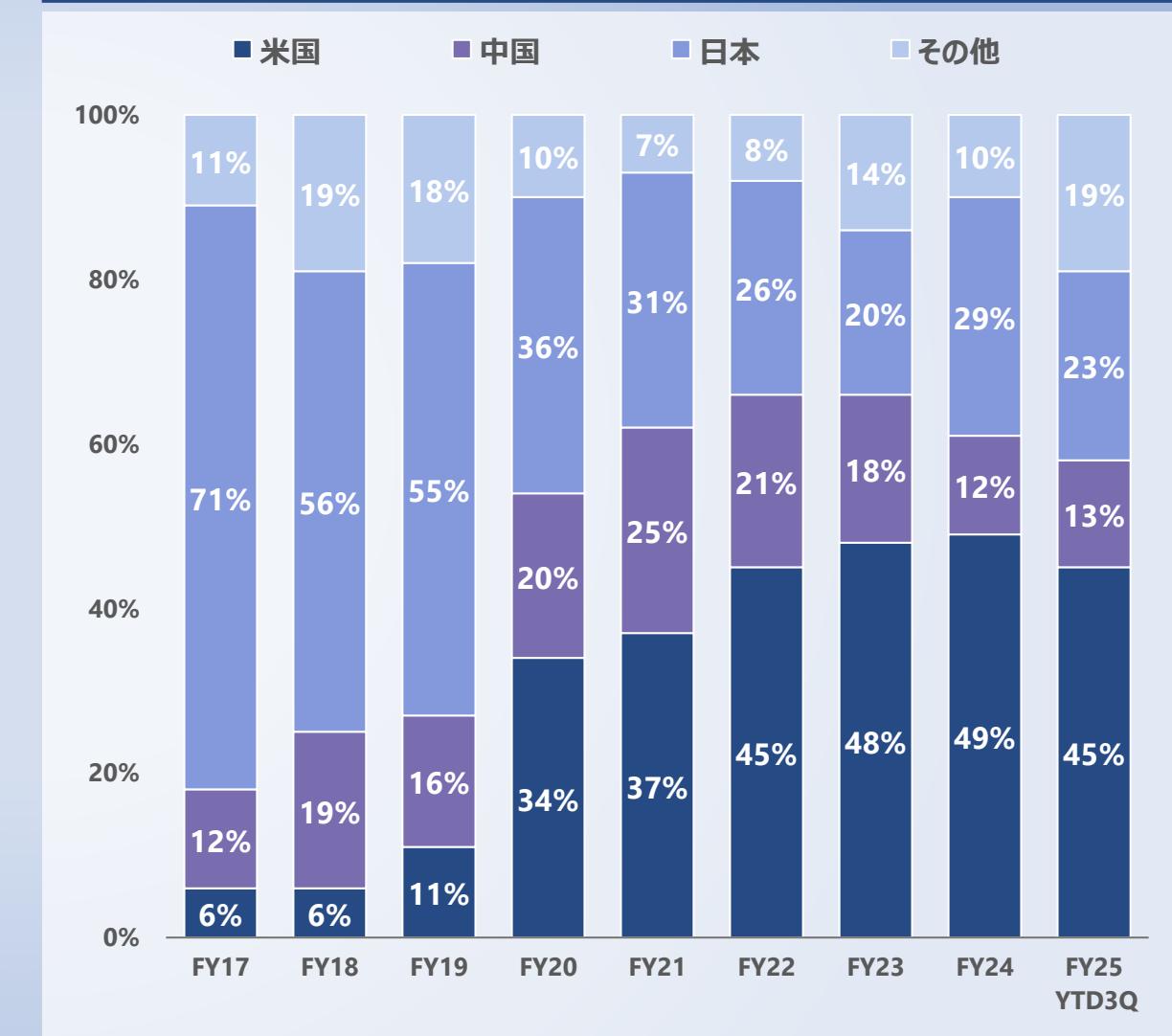
■ オートモーティブ ■ データセンター/ネットワーク ■ スマートデバイス ■ インダストリアル ■ その他



売上高

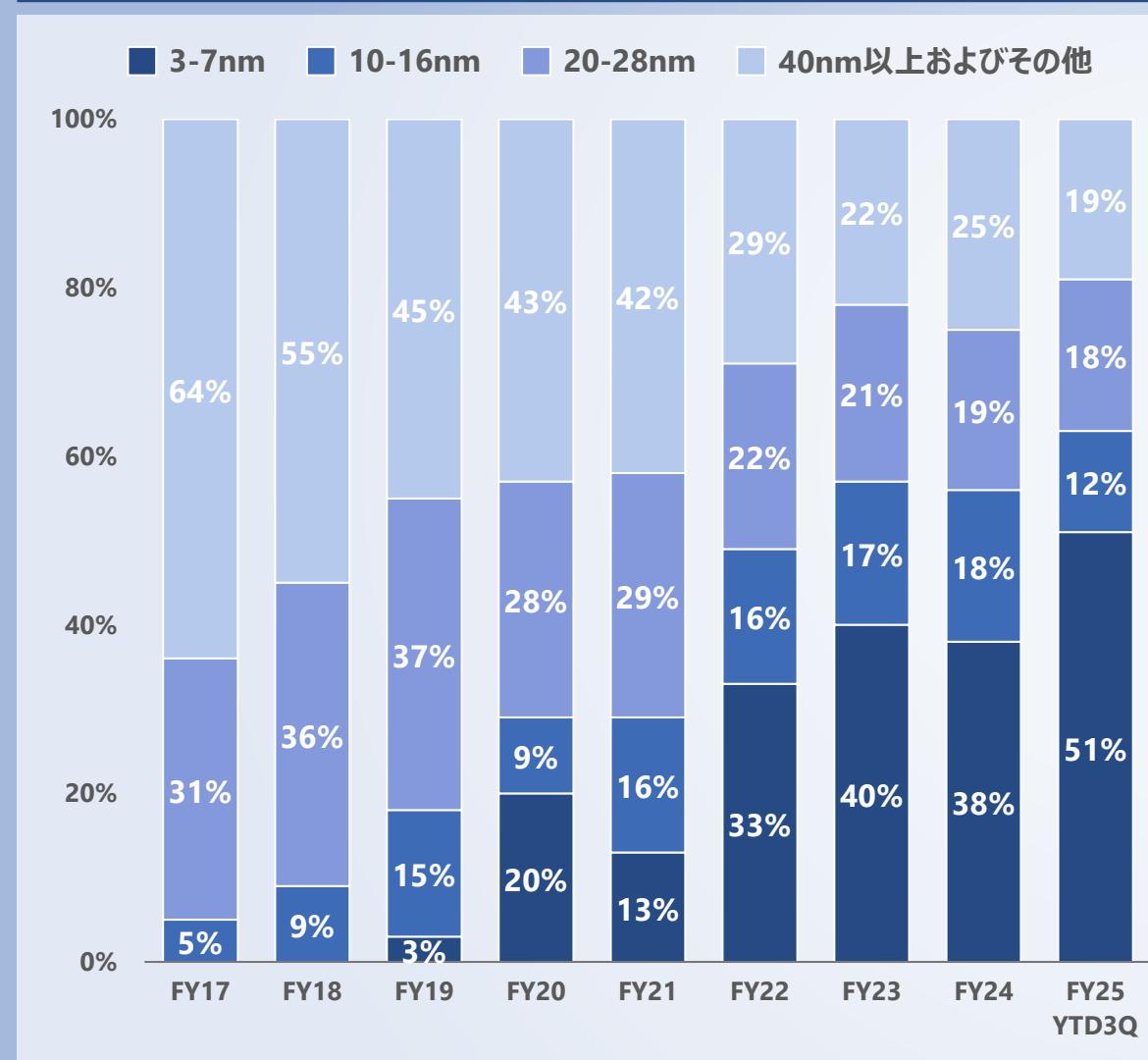


NRE売上

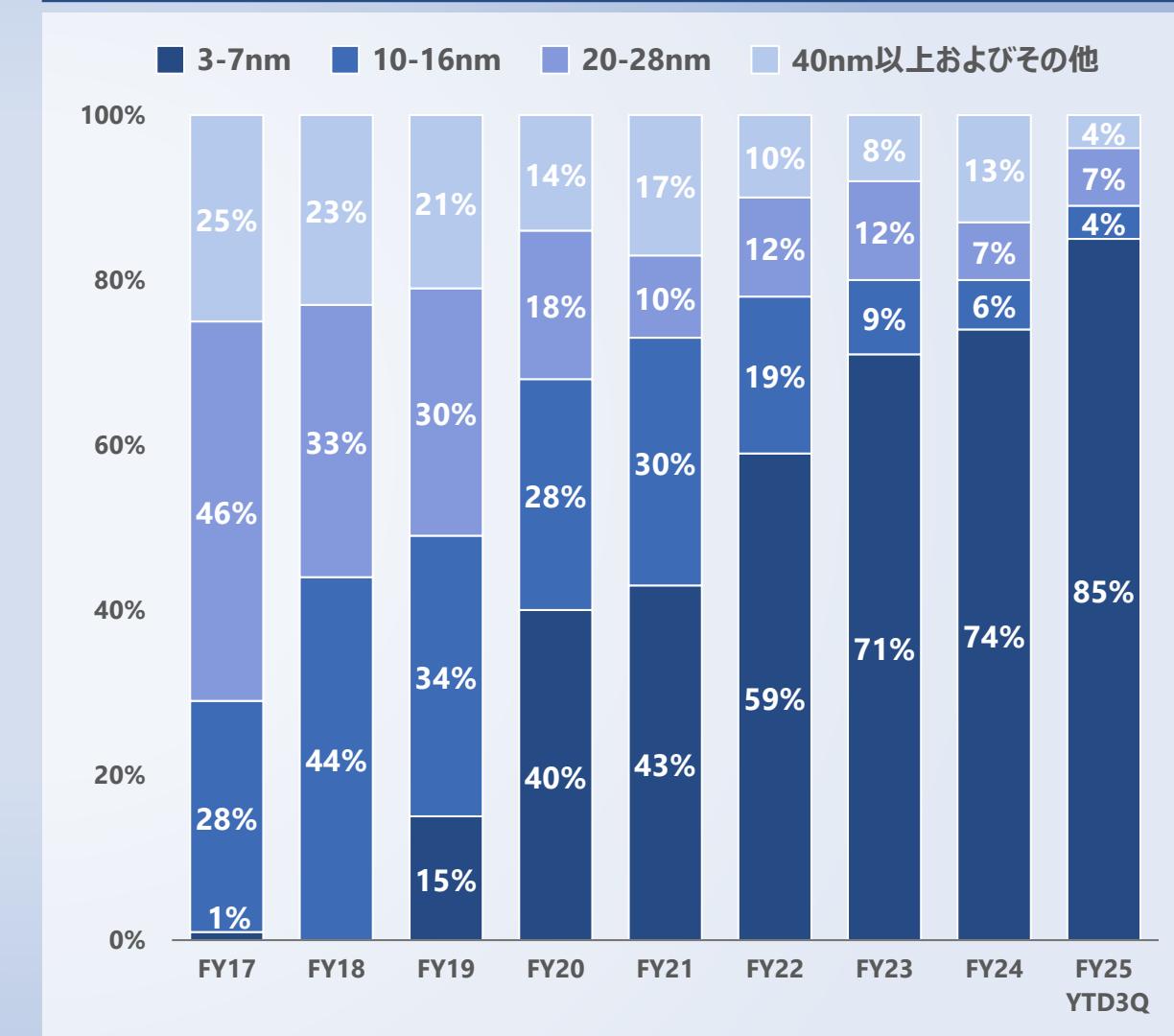


売上の内訳（プロセスノード別）

売上高



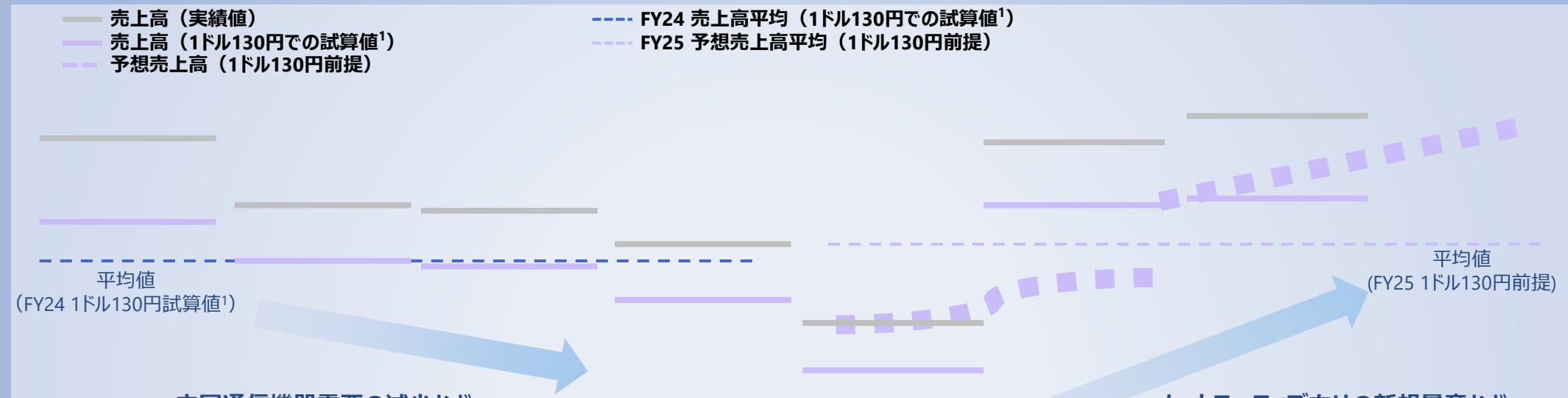
NRE売上



(単位：億円)	2024年度 実績	2025年度予想 4月時点(当初予想)	2025年度予想 10月時点	当初 予想比	増減率
売上高	1,885	1,750	1,900	+150	+8.6%
営業利益	250	140	100	-40	-28.6%
営業利益率	13.3%	8.0%	5.3%	-2.7pt	
当期純利益	196	105	67	-38	-36.2%
純利益率	10.4%	6.0%	3.5%	-2.5pt	
1株当たり当期純利益¹	109円78銭	59円83銭	38円16銭		
1株当たり配当金	50円00銭	50円00銭	50円00銭		
為替レート（USD/JPY）	152.6円	130.0円	138.0円		

- 2025年度4月時点予想における為替感応度は、ドルに対して1円の変動で、売上高約10億円、営業利益約3億円程度、他の通貨についての影響は軽微と想定しています。
- 2025年度10月時点予想における年間での為替感応度は4月時点予想から据え置いています。ただし、外貨建てによる売上高・仕入高・棚卸資産金額と、研究開発費の発生時期により、四半期毎にその影響は異なります。

1. 2024年度実績の1株当たり当期純利益は178,543,635株、4月時点の2025年度予想は175,482,641株、10月時点の2025年度予想は175,558,918株を前提に算出しています。この変動はストックオプションの行使及び自己株式取得に伴うものです。
 2. 予想の取り扱いについては、P2免責事項をご参照ください。



1Q

2Q

3Q

4Q

FY24

1Q

2Q

3Q

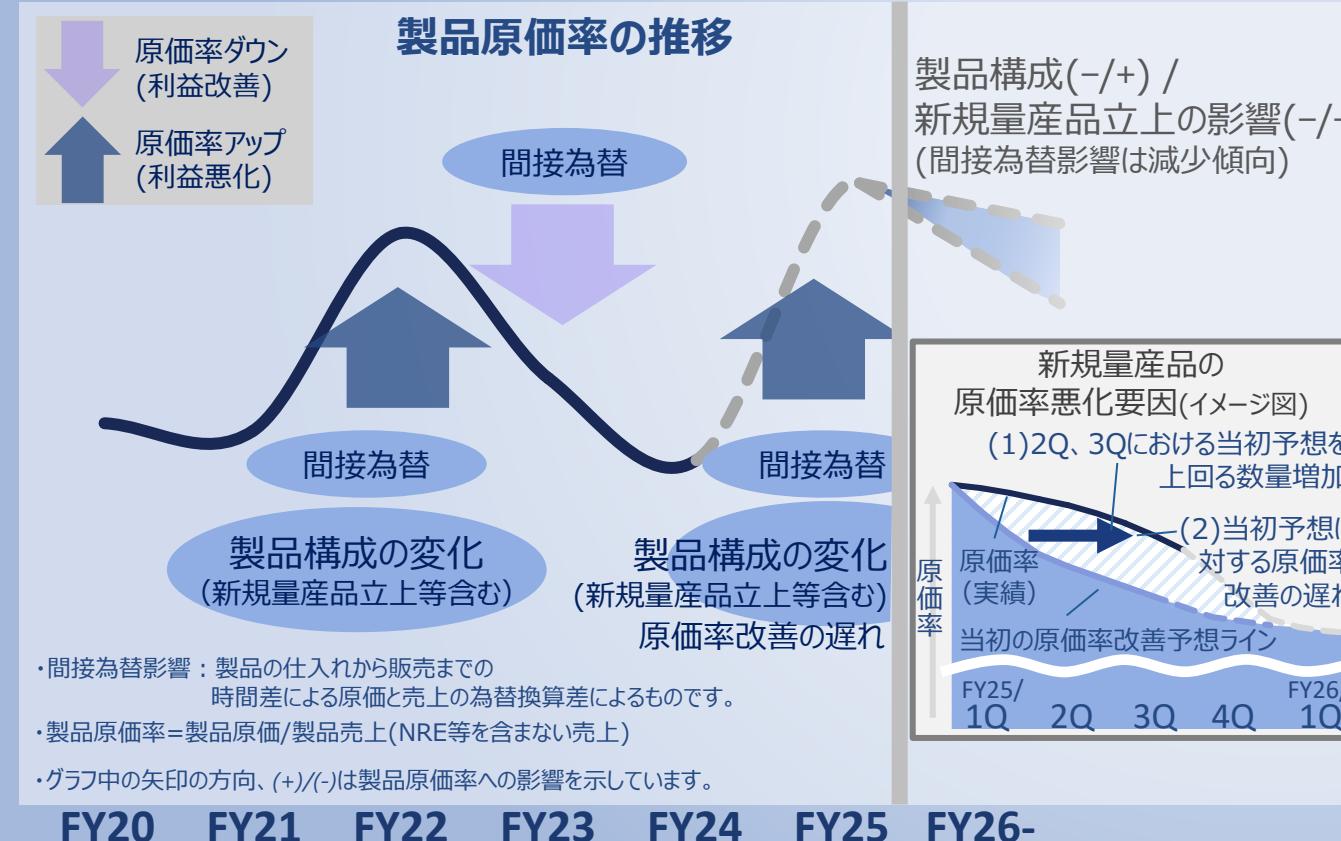
4Q

FY25

- ◆ FY25上期
 - ・在庫調整による中国通信機器需要の減少などの影響が継続するも、オートモーティブ向け新規量産の拡大などにより、当初予想を上回る
- ◆ FY25下期
 - ・オートモーティブ向け新規量産の需要が当初予想を上回る可能性
- ◆ 営業利益率
 - ・当初予想では、営業利益については「前年度を下回るもの、今年度下期からの改善」を見込んでいましたが、
 ①製品原価率の上昇(製品粗利率の悪化)と②先行開発費の増加により、売上高増に伴う改善が遅れることとなりました。この①製品原価率の上昇(製品粗利率の悪化)の要因は、比較的原価率の高い(製品粗利率の低い)新規品の量産開始による製品構成の変化に加え、この新規量産の原価率の高い(製品粗利率の低い)量産初期段階での〈当初予想を上回る数量增加〉と〈当初予想に対する原価率改善の遅れ〉、また、間接為替影響によるものです。
 しかし、製品原価率の改善が進み、今年度末から来年度にかけて営業利益率の改善が進んでいくと見ています。

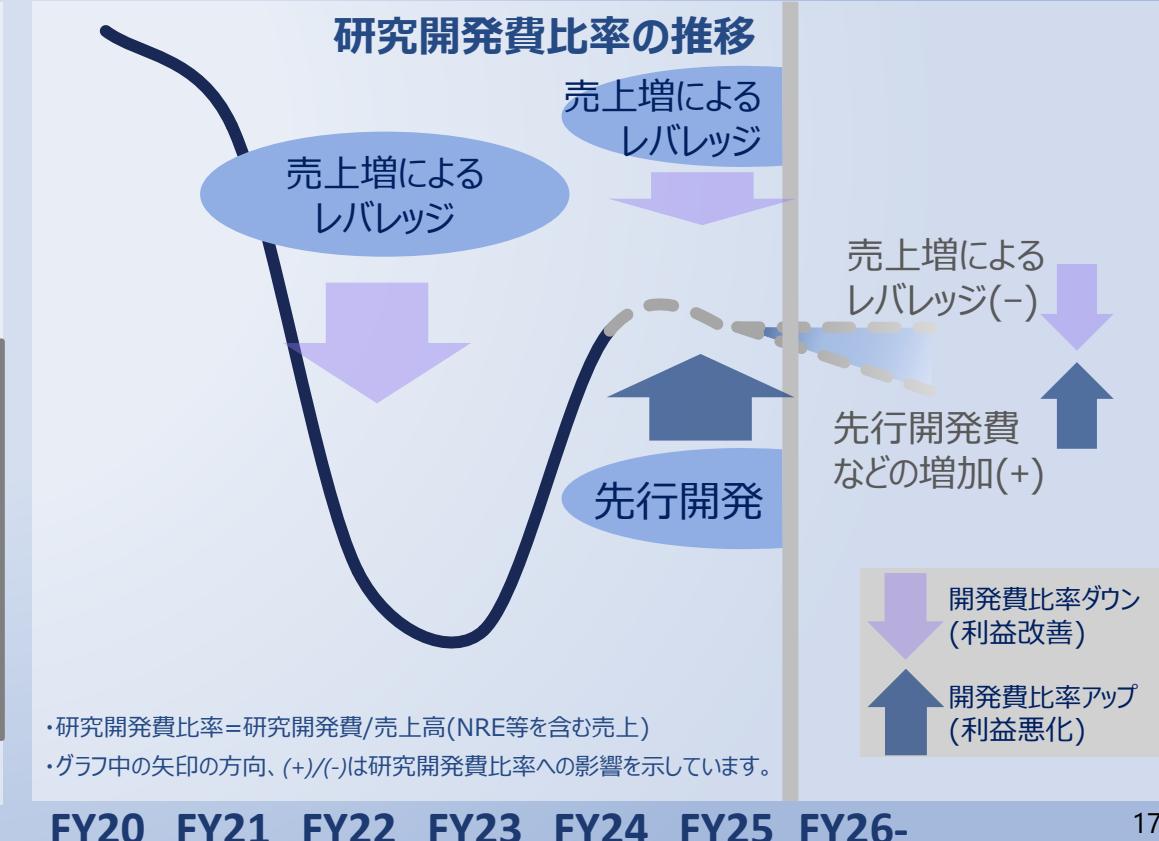
製品原価率の見通し

- FY25の製品原価率は、以下の要因によりFY22より高い水準に
 - ・比較的原価率の高い新規品の量産開始に伴う製品構成の変化
 - ・加えて、上記新規量産品の原価率の高い量産初期段階での
 - 〈(1)当初予想を上回る数量増加〉と〈(2)当初予想に対する原価率改善の遅れ〉
 - ・間接為替影響
- FY26以降、製品構成の変化や新規量産の状況によるものの、改善して行く見通し



研究開発費比率の見通し

- 先端分野での当初予想を上回る積極的な投資により、FY25の対売上高研究開発費比率はFY24と同水準を予想（先端品の積極的な受注に向けた開発強化が影響）
- FY26以降、売上増によるレバッジで徐々に低下する可能性



市場トレンドと商談獲得



オートモーティブ

- AD/ADAS関連の技術、サービスのイノベーションが継続
- AIがイノベーションを加速、オートモーティブ分野での先端SoCの活用が拡大
- サービス指向企業、新興OEMそして既存大手OEMの間の競争が激化、自動車産業の構造的变化が進行
- 既存大手OEMにも動きが



データセンター/ネットワーク

- 生成AIの登場などを背景にデータセンターの処理能力が大幅に増加
- CPUやxPU(AI)、Switchなどの差別化需要が高まり、カスタムSoCのビジネス機会が拡大
- より大規模な設計や、先端技術(2nm/14Å, 3D/5.5DやCo-Packaged Opticsなど)の採用ニーズが高まる



インダストリアル/スマートデバイス (フィジカルAI)

- 先端顧客とのプロジェクトが継続する一方、高付加価値製品への需要も引き続き高水準
- AI活用やネットワーク化の進展により、先端技術を活用するSolution SoCビジネスモデルへの需要が産業分野で拡大
- フィジカルAI導入の兆し

商談獲得の動向:

- 新たな製品・サービスの登場、SoC設計の複雑化、SoC工コシステムの進化を背景に、カスタムSoCの需要が拡大
- 上記領域で大型案件を獲得し、前年度並みの商談獲得金額の達成を目指す

2025年度 予想(2025年10月更新)

売上高は増加する一方で、営業利益は減少を予想

■ 製品売上

- 第1四半期で底を打ち、第2四半期よりオートモーティブ分野の新規量産品の立ち上がり等により成長軌道に戻る
- 2025年度通期の製品売上は当初予想を上回る見込み

■ NRE売上

- 2024年度と同水準または微増を予想

■ 営業利益

- 2025年度通期営業利益は①製品原価率の上昇(製品粗利率の悪化)と②先行開発のための開発費の増加により当初予想に対し減少
- 製品原価率上昇の要因

: 比較的原価率の高い(製品粗利率の低い)新規品の量産開始による製品構成の変化と間接為替影響に加え、この新規量産品の原価率の高い(製品粗利率の低い)量産初期段階での(当初予想を上回る数量増加)と(当初予想に対する原価率改善の遅れ)により製品原価率上昇(製品粗利率悪化)

<為替レート前提>

- 為替レート : 下期 1ドル=130円 (4月時点予想から変更なし)
(年間平均 138.0円)
- 為替感応度 : 売上高 約10億円 / 営業利益 約3億円
- 年間での営業利益に対する為替感応度は4月公表の約3億円を据え置き。ただし、外貨建てによる売上高・仕入高・棚卸資産金額と、研究開発費の発生時期により四半期毎にその影響は異なる。

2026年度以降 (見通し)

2025年4月時点の中期トレンド見通しを維持

■ 製品売上

- 2026年度 : AD/ADAS向けSoCプロジェクトの継続的な成長を見込む。2025年度の新規量産品に加え、北米オートモーティブとデータセンター向けを含む複数のプロジェクトの新規量産も始まる見通し
- 2027年度以降 : 2022~2024年度に獲得したプロジェクトの量産開始による更なる成長を見込む

■ NRE売上

- 繼続的に緩やかな増加を見込む

■ 営業利益

- 製品粗利率 : 新規量産品の状況等によるものの、2025年度に対しての改善を見込む
- 研究開発費比率 : 積極的な先行投資を継続するものの、売上高増加に伴うレバッジ効果により、2025年度と同水準、あるいは徐々に低下する見通し
- 販売費及び一般管理費比率 : 売上高増加に伴うレバッジ効果により徐々に低下していく見通し
- 営業利益率トレンド : 2025年度は4月時点の予想を下回るもの、売上高成長に伴うレバッジ効果などで、今後数年間、2025年4月時点の見通しに沿った営業利益率の推移を見込む



- 更なる成長に向けた先端技術分野への積極的な投資
- 成長重視の経営を加速



Appendix:

Overview

- 連結損益計算書・連結貸借対照表
- 売上高の内訳 四半期別



連結損益計算書

(単位：億円)	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度YTD3Q
売上高	997	1,170	1,928	2,212	1,885	1,421
前年同期比増減率	-3.7%	+17.3%	+64.7%	+14.8%	-14.8%	-2.2%
製品売上	731	846	1,568	1,829	1,466	1,147
NRE 売上	230	281	349	376	410	269
その他売上	36	43	11	8	9	6
売上原価	432	498	1,039	1,112	846	764
売上総利益	565	673	888	1,100	1,039	658
売上総利益率	56.7%	57.5%	46.1%	49.7%	55.1%	46.3%
製品粗利益率	40.9%	41.2%	33.7%	39.2%	42.3%	33.4%
研究開発費	392	432	493	533	598	442
販売費及び一般管理費 (研究開発費除く)	158	156	178	212	191	143
営業利益	16	85	217	355	250	72
営業利益率	1.6%	7.2%	11.3%	16.1%	13.3%	5.1%
営業外損益	4	6	18	16	1	-6
経常利益	20	91	234	371	251	66
特別利益	0	0	0	0	18	0
特別損失	0	0	0	0	15	0
税金等調整前純利益	20	91	234	371	254	66
法人税等合計	5	16	37	110	58	19
当期純利益	15	75	198	261	196	48
純利益率	1.5%	6.4%	10.3%	11.8%	10.4%	3.4%
為替レート(USD/JPY)	106.1	112.4	135.5	144.6	152.6	148.7

連結貸借対照表

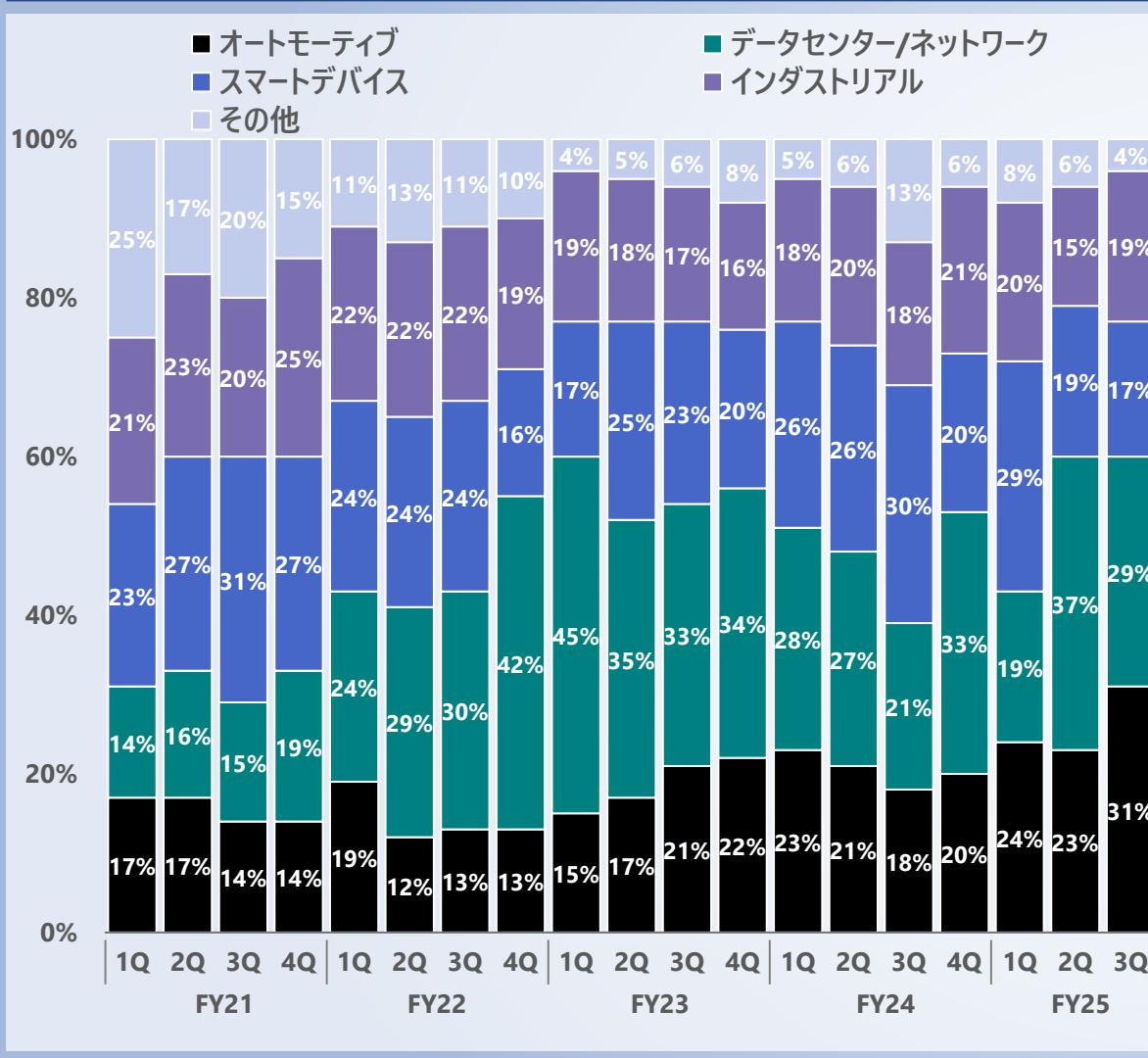
(単位：億円)	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 3Q		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 3Q	
資産	資産							負債及び純資産						
現金及び預金 ¹	427	463	451	697	728	438	買掛金	120	166	234	158	119	158	
売掛金	286	251	408	353	316	326	未払金・未払費用	74	69	303	182	120	94	
棚卸資産 ²	67	164	477	255	170	328	その他	19	39	286	191	73	71	
その他	26	29	224	84	48	84								
流動資産合計	806	906	1,561	1,389	1,263	1,176	流動負債合計	213	274	823	531	313	323	
有形固定資産	89	116	172	218	223	236	固定負債合計	13	14	17	27	20	22	
Reticle	37	47	56	81	97	110	負債合計	226	288	841	558	333	344	
その他有形固定資産	52	69	116	137	126	126	資本金	302	302	302	327	330	330	
無形固定資産	116	122	130	185	144	163	資本剰余金	302	302	302	327	330	339	
繰延税金資産	23	31	69	67	61	47	利益剰余金	214	289	486	636	743	702	
その他	9	8	8	9	12	11	自己株式	0	0	0	0	-50	-108	
固定資産合計	237	278	379	479	440	457	その他	-1	3	8	20	18	26	
総資産合計	1,042	1,184	1,939	1,868	1,703	1,633	純資産合計	817	896	1,099	1,310	1,370	1,289	
							負債純資産合計	1,042	1,184	1,939	1,868	1,703	1,633	

1. 現金及び預金には短期保有有価証券を含みます。

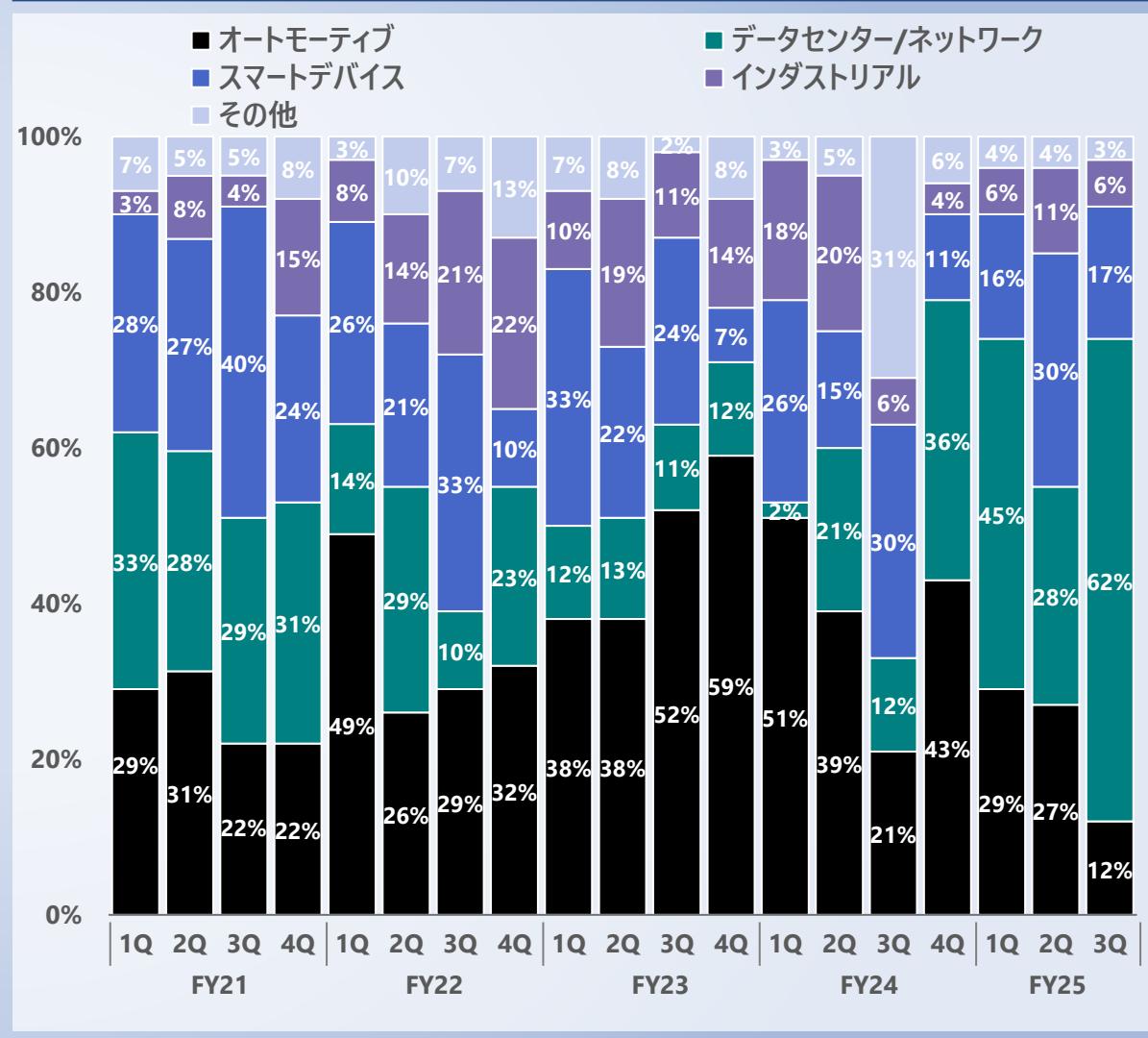
2. 棚卸資産は製品と仕掛品の合計です。

売上の内訳（アプリケーション別）四半期別

売上高¹



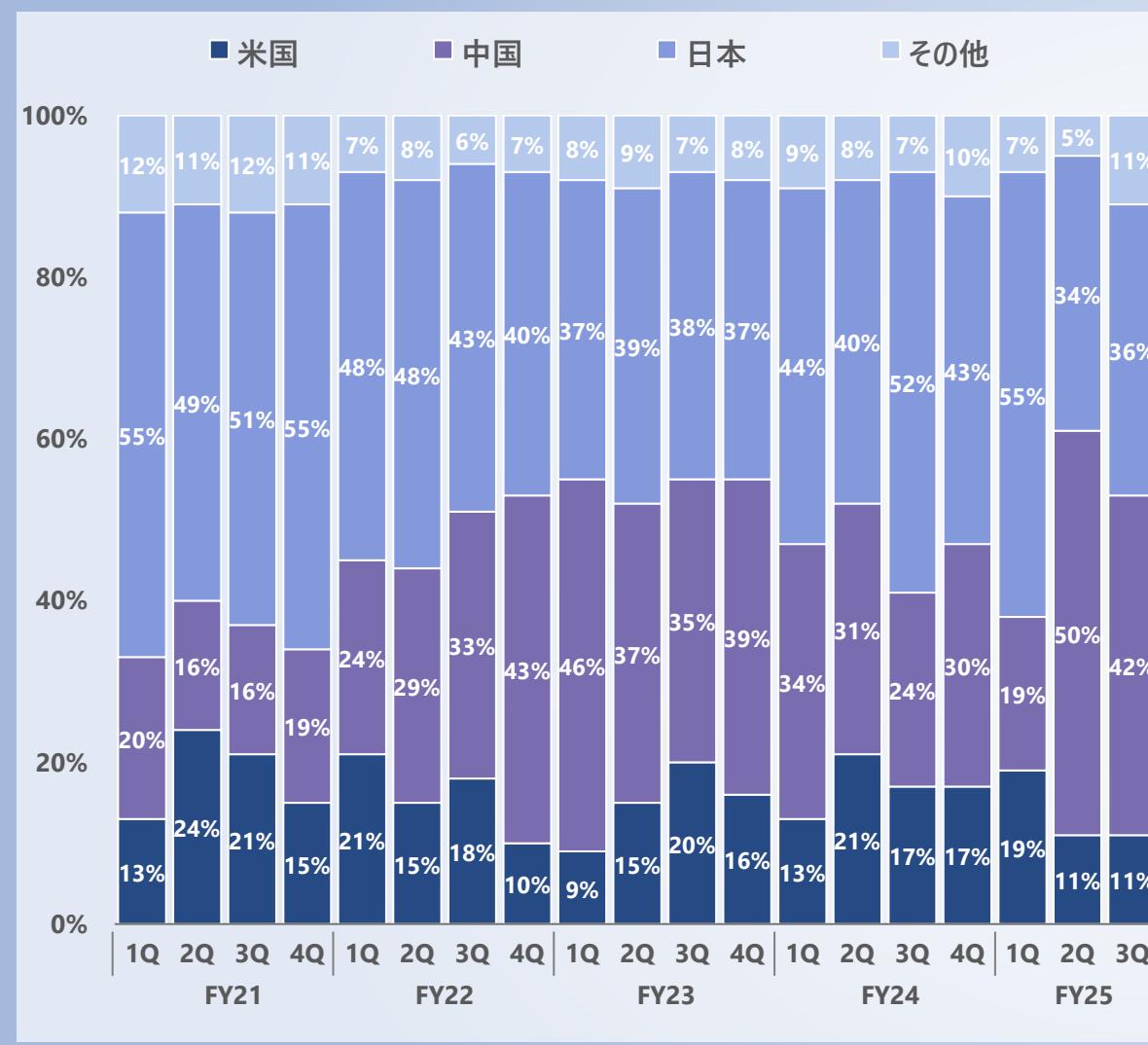
NRE売上¹



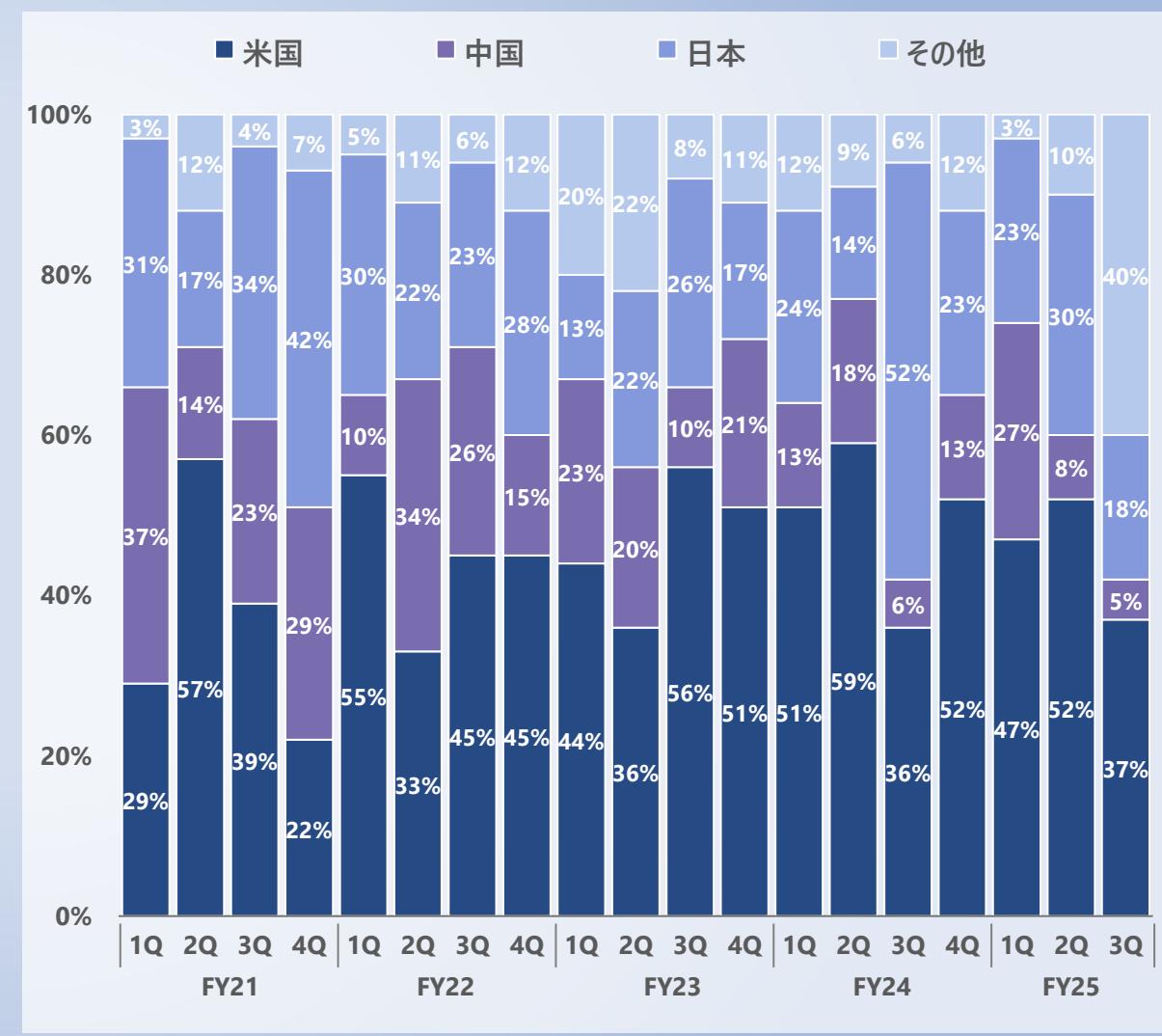
1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

売上の内訳（地域別）四半期別

売上高¹



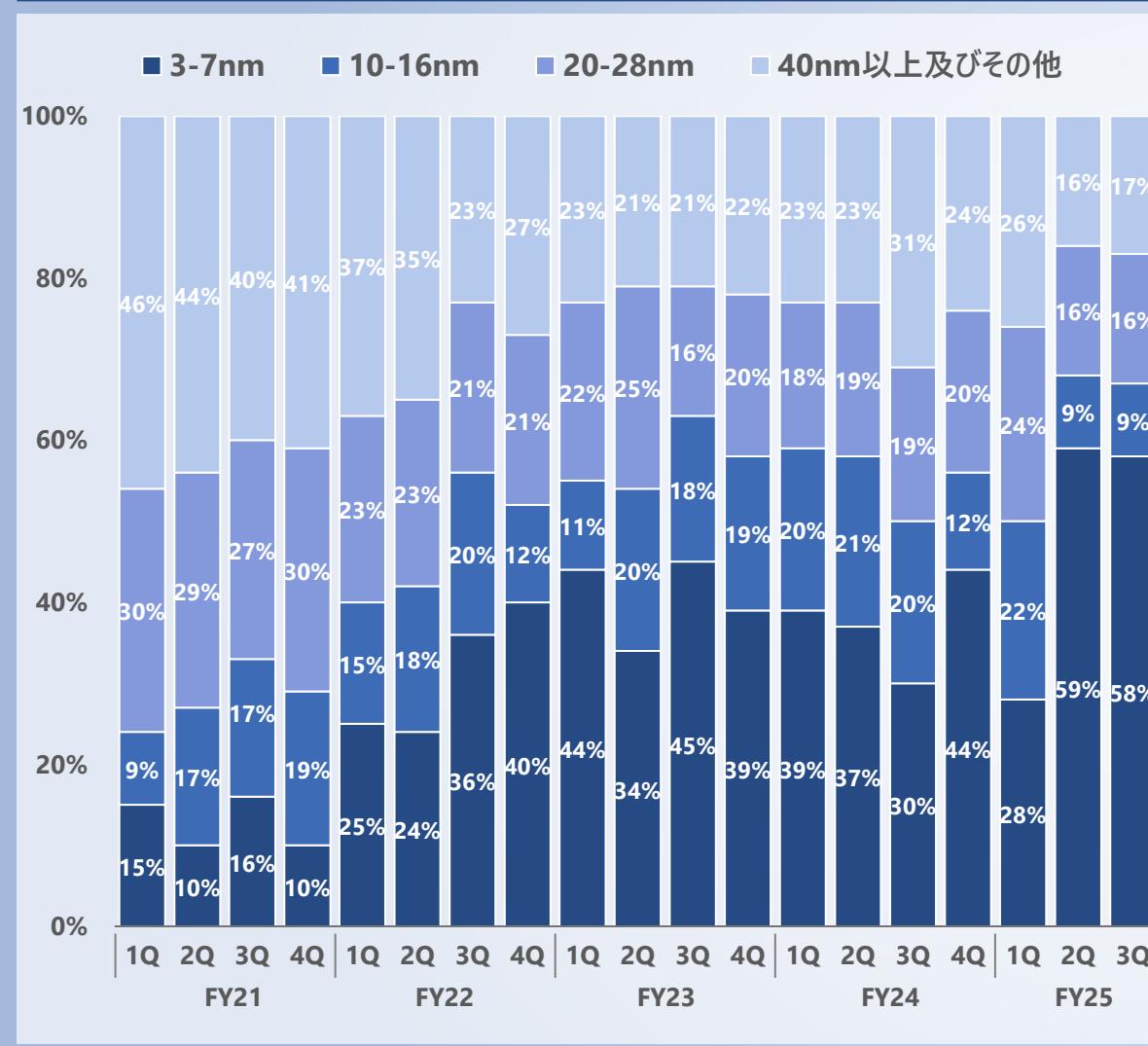
NRE売上¹



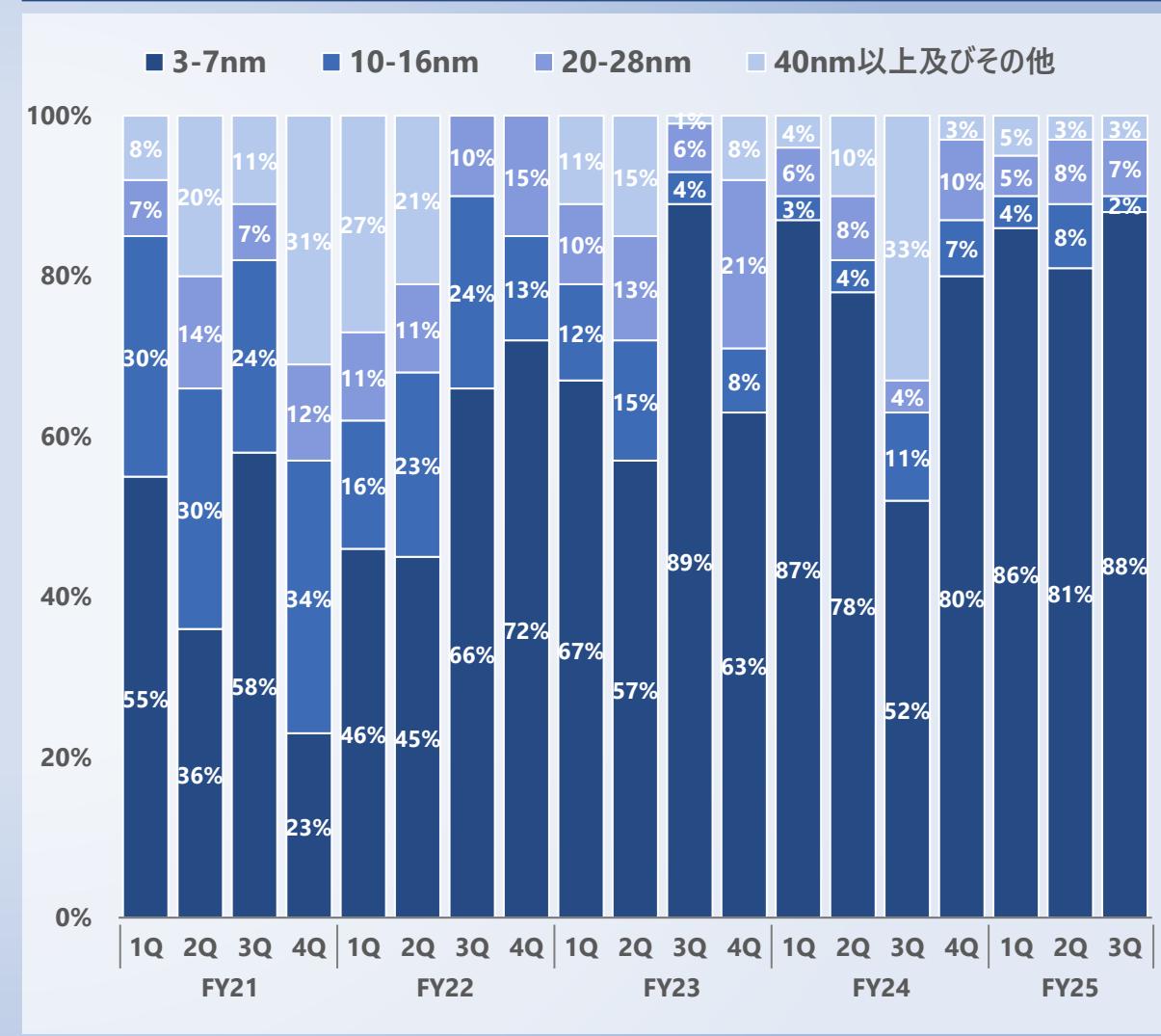
1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

売上の内訳（プロセスノード別）四半期別

売上高¹



NRE売上¹



1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。



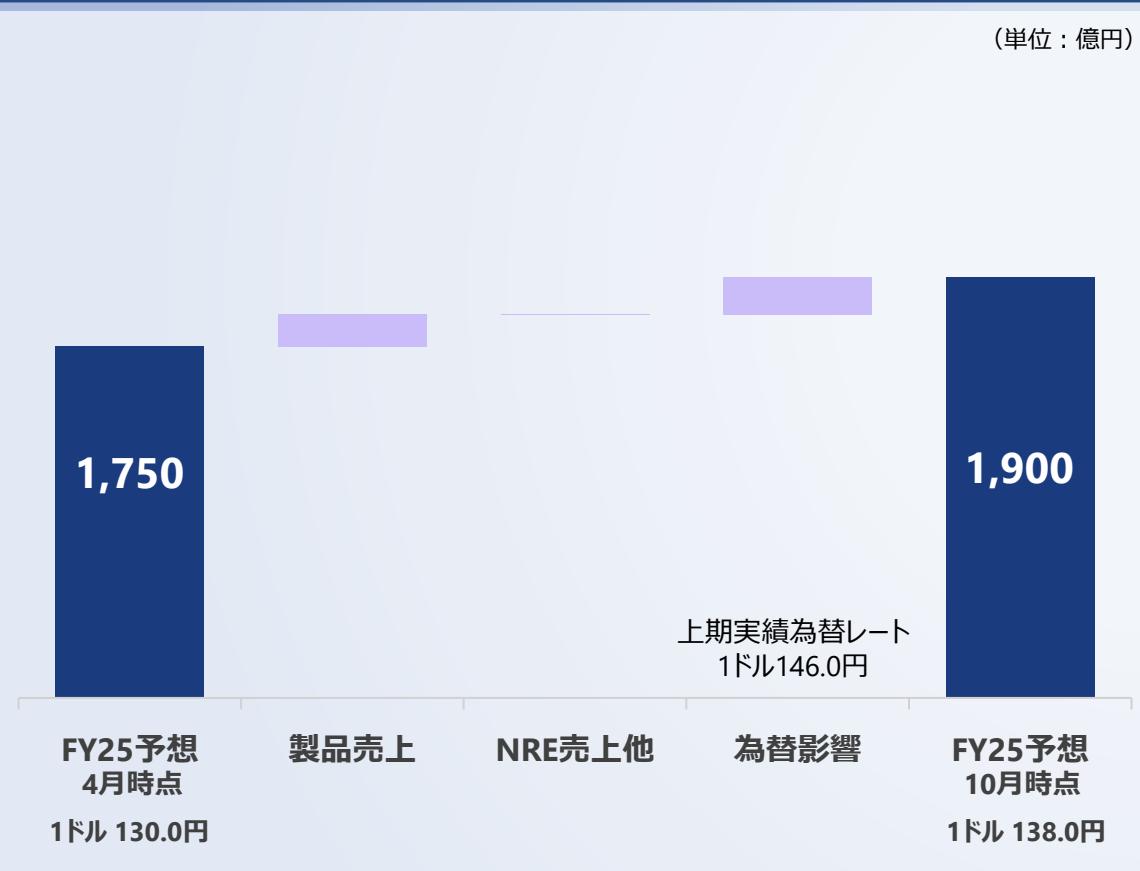
以降、2025年10月決算説明会資料より再掲資料



- 売上高は、新規量産品への需要の大きさを考慮し、当初予想比+150億円増の1,900億円に修正
- 営業利益は、①製品構成の変化に伴う製品粗利率の悪化と、②先行開発費の増加を反映し、当初予想比 -40億円減の100億円に修正

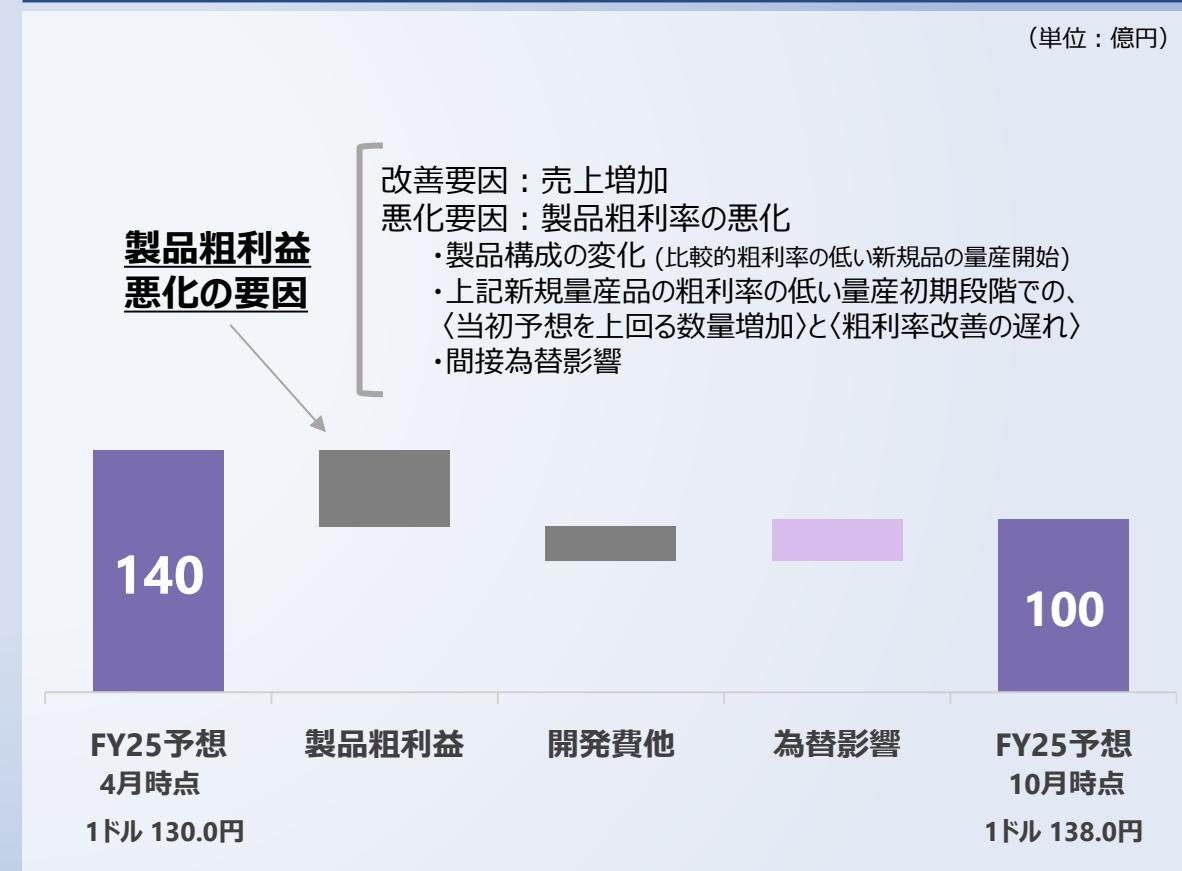
売上高（当初予想比）

(単位：億円)



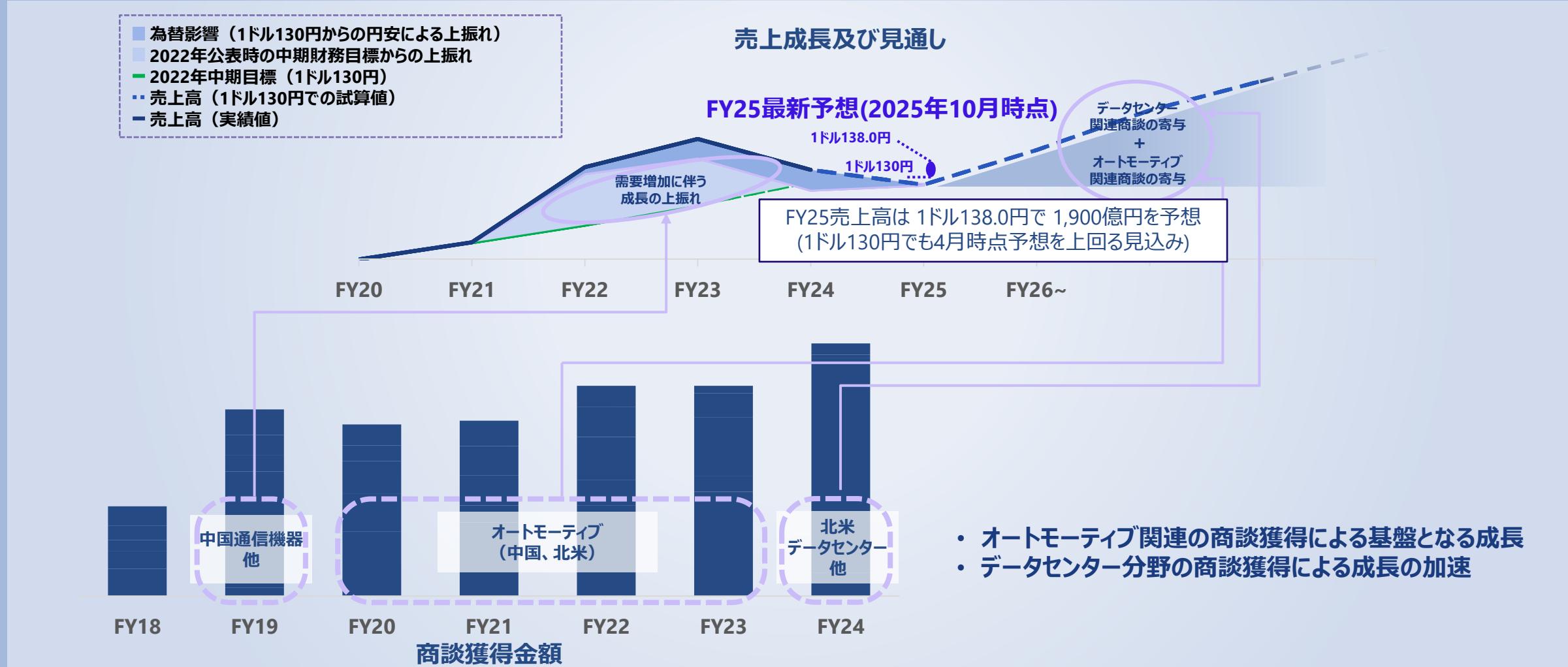
営業利益（当初予想比）

(単位：億円)



➤ FY2025下期の為替レートの前提是1ドル130円を想定しています。（FY2025上期実績為替レート：1ドル146.0円）

- 商談獲得の増加が、開発期間を経て量産時期に至ると、製品売上増となり、売上成長を導く
- 2022年度-2023年度の業績上振れは、中国通信機器向けの需要前倒しによる



- 営業利益率は、2026年度以降の売上高成長とともに、再び改善していく見通し

2021年度以降の営業利益率の推移 (為替レート1ドル130円での試算値と見通し)



	~ 2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度~	
製品粗利率	■ (-) 製品構成の変化 	■ (+) 調達に係る間接的な為替影響による改善 	■ (+) 製品構成の変化 ■ (+) 調達に係る間接的な為替影響による改善 	■ (-) 製品構成の変化 ■ (-) 新規量産品の量産初期段階での当初予想を上回る数量増加・当初予想に対する原価率改善の遅れ ■ (-) 調達に係る間接的な為替影響の悪化 	■ (+/-) 製品構成の変化 ■ (+) 量産後の原価率改善及び(-) 新規量産品の初期立上 ■ (+) 調達に係る間接的な為替影響は減少 	
研究開発費比率	■ (+) 売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善 		■ (-) 開発体制強化に加え、先行開発により費用増 	■ (-) 先行技術への投資による費用増 ■ (+) 売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善 	■ (-) 先行技術への投資による費用増 ■ (+) 売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善 	
販管費比率	■ (+) 売上高の拡大に伴う販管費比率の改善 	■ (-) 販管費は減少するも売上高減により販管費比率増 	■ 販管費はほぼフラット 	■ (+) 売上高の拡大に伴う販管費比率の改善 ■ (-) 積極的なIT投資 	利益悪化	
為替レート(円/ドル)	112.4	135.5	144.6	152.6	138.0	130.0 利益改善

表中の矢印及び +/- は営業利益率への影響を示しています。

予想の取り扱いについては、P2免責事項をご参照ください。

半導体市場のトレンドとカスタムSoC/Solution SoCビジネスモデルの要求拡大の背景

- ・新しいサービスやアプリケーションの登場
- ・SoCエコシステムの進化
- ・3D/5.5DとChipletの時代へ
- ・複雑化する設計 = “Entire Design（全体設計）”
- ・Bespoke vs ASSP
- ・様々なアプリケーション市場におけるSolution SoCビジネスモデルへの新たなニーズ



ソシオネクストの取り組み

積極的な先行開発投資

先端技術分野における最近の活動

Chiplet時代に向けたソシオネクストの取り組み

アプリケーション市場別のビジネス展開

「Entire Design（全体設計）」能力の強化とグローバル組織体制の抜本的な改革

AI技術とSoC技術の進化のスパイラルが市場拡大を加速

新しいサービスやアプリケーションの登場

- SoC技術の進化にともないAIの活用が拡大
- 技術の進化により新たなサービスやアプリケーションが生まれ、それに合わせて最適化されたSoCを要求
- 最適化され高度な機能を実現する“Solution SoC”ビジネスモデルを採用する顧客が増加、データセンター、ネットワーキング、自動車、Physical AIなどの分野で様々なIPとプロセッサーを統合

SoCエコシステムの進化

- 垂直統合が進む一方、SoCエコシステムのオープン化も進展、より機能的なIPやChipletオプションが市場で利用可能に
- さらに、競争力のあるIPサブシステムとオープンソースソフトウェア (OSS) の可用性が向上

3D/5.5DとChipletの時代へ

- Chiplet、パッケージング、次世代プロセスノード (2nm/14 Å) の急速な進展
- さらなる設計の複雑さなど、新たな課題が顕在化

複雑化する設計 = “Entire Design（全体設計）”

- アーキテクチャ、サーマルマネジメントやテストを統合した“Entire Design（全体設計）”アプローチは、データセンターや自動車などの先進的な分野で不可欠
- Chipletのような新しいテクノロジーの複雑さが“Solution SoC”ビジネスモデルの有効性を拡大

Bespoke vs ASSP

- More than Mooreの時代には、革新的な顧客は独自のPPA目標を満たすカスタムSoCを要求、ベンダーロックインを避けるためにASSPから離れる傾向
- AIの急速な進化は、カスタムSoCへの移行を加速

様々なアプリケーション市場におけるSolution SoCビジネスモデルへの新たなニーズ

- 先進的な次世代製品・サービスに必要なIPとプロセッサーを統合するために顧客は“Solution SoC”ビジネスモデルを採用
- AIが自動車やロボットなどの新しい分野に拡大することでカスタム（Bespoke）SoCの需要が拡大

AIを活用した新たなサービスやアプリケーションの登場と幅広い分野に広がる半導体エコシステムの進化

- 革新的な顧客は、先端SoC開発のために「Entire Design（全体設計）」能力があるパートナーを求めている
- 「Entire Design（全体設計）」や「コンプリートサービス」を実現するための先行投資が必要

<市場動向と要求>

新しいサービスとアプリケーション

テクノロジーの進化により新たなサービスやアプリケーションが生まれる：AIを活用したサービスやアプリケーションの拡大により、最適化されたSoCの需要が拡大

設計の複雑さ / Entire Design

「Entire Design（全体設計）」の難しさが増し、システムファンクション、サーマルマネジメント、組立、テストでアーキテクチャー設計・システム設計がより重要に＝データセンターや自動車など、高度な技術を必要とする分野で「Entire Design（全体設計）」の重要性が高まっている

- More than Moore
PPAが過去のレートで改善しなくなった「More than Moore」時代のASSPのパフォーマンスに対する不満とロックインの懸念
- 3DとChiplet
Chipletの進化(ホモジニアス>>>ヘテロジニアス)、パッケージング技術、プロセスノードの進化が続く(2nm/14Å)
- SoCエコシステムの革新
ChipletはSoCの設計と開発をより効率的にする一方、より複雑に

設計プロセスの効率化

AI導入による設計プロセスの効率化

効率化のための検証・テスト技術の進化

<「Entire Design（全体設計）」や「コンプリートサービス」を実現するための先行投資>

先端テクノロジー

光データ伝送、データセンターやHPCのような分野の新製品・新サービスで使用するSerDesやCPO (Co-Packaged Optics) などの先端技術を活用
(パートナー・イノベーティブな顧客とのパートナーシップ強化)

2nm以細のテクノロジーノードとChiplet (3D/5.5D)

Chiplet技術と2nm以細のプロセスノードを組み合わせた開発
高度なパッケージングテクノロジーの開発 :3D及び新しいDie-to-Die接続

- 3D/5.5D技術
- 新たなパッケージ/アセンブリ技術のための高信頼性解析技術
(テスト、熱解析、On-die解析など)

SoC設計へのAIの活用

設計効率とPPAを実現するためEDA企業と協力、
SoCの設計プロセスに積極的にAIを組み込む

半導体エコシステム企業とのパートナーシップ

グローバルSoCエコシステムパートナーとの協力関係の拡大・加速

エコシステムパートナーとの3D/5.5D、Chipletなどの先端技術開発について発表

■ Socionext Expands 3DIC Support with Advanced 3D Die Stacking and 5.5D in Packaging Portfolio

(August 28, 2025)

■ Socionext and imec Update Core Partner Program Strengthening Collaboration in Research and Development of Chiplet and Advanced Logic Semiconductor Technologies

(September 11, 2025)

■ Socionext Unveils “Flexlets™”, a Configurable Chiplet Ecosystem to Accelerate Multi-die Silicon Innovation

(October 28, 2025)

A screenshot of a website page for Socionext. The header features the company name "socionext™" in a large, stylized font with a blue-to-white gradient, followed by "The Solution SoC Company". Below the header is a sub-header "PR20200813_1_22". The main content area has a light gray background. It includes a "Press Release" section, a "Socionext Expands 3DIC Support with Advanced 3D Die Stacking and 5.5D in Packaging Portfolio" section with a sub-section "Production-Ready 3DIC Technology for Compact, Power-efficient Consumer Applications and High-performance AI and HPC Devices", and a "Vertical Stacking, Limitless Potential with the 3Dc Design" section with a sub-section "Building on the company's expertise in 2.5D designs, Socionext applies proven design experience and IC components vertically to unlock key advantage". There are also sections for "socionext™ The Solution SoC Company", "Processor IP Library", and "Partners & Ecosystem". A "socionext" logo is at the bottom left, and a "socionext.com" link is at the bottom right.

■ Chiplet Solutionの必要性

- レチクルサイズの限界、歩留向上、大規模Monolithic SoCでの新規IPのリスク、インターフェースの柔軟性

■ Chiplet設計には、複数の高度なテクノロジーの専門知識が必要

- DFT・テスト、先端パッケージ、サーマルマネジメント、シグナル・インテグリティー／パワー・インテグリティー、相互接続プロトコル、歩留および信頼性エンジニアリング

■ パフォーマンスとコストの最適化にはカスタムSoC設計が必要

- 汎用のチップでは差別化ができない、アプリケーションのPPA要件を満たすことができない

“Flexlets” - RTL-configurable chiplets

Solution SoCビジネスモデルに沿った、 End-to-Endのカスタム(Bespoke)SoC設計のために統合された柔軟性のあるChipletプラットフォーム

- 高性能コンピューティング、先進的なネットワーキング、次世代の自動車システムといった先進のアプリケーションにおいて、顧客独自のニーズに応じて性能を最適化できる柔軟性を提供
- 機能が固定されたハードウェアソリューションや自社のエコシステム内に限定されたクローズドなエコシステムの制約から解放し、あらゆるベンダーの最高水準のIPを活用・統合、差別化された機能を共同で設計できる環境を提供
- 「アーキテクチャーの真の柔軟性」、「シームレスなカスタムIP統合」、「最適な3rd Party IPを選択可能」、「設計初期からのPPA最適化」により「真に差別化された製品」を実現

セキュリティ機能、デバッグ機能、最適化されたインターフェースを実装したFlexletsのラインアップを順次展開する予定

顧客は、個別のアプリケーション要件に応じてRTLレベルでFlexletsの設計をカスタマイズすることが可能

Flexletsベース設計による最初のエンジニアリングサンプル（KGD = Known Good Die提供含む）を開発中、2025年中に最初の顧客向け製品の設計開始、2026年第2四半期よりさらに拡大

Flexletsラインアップにより、適応性、高性能、そして革新性を追求する次世代半導体に向けたスケーラブルなモジュール型設計基盤を提供

Smart Devices

- この分野での新技术への需要は、AI活用の広がりもあり、引き続き堅調
- コンピューター・ビジョン、ARなどのアプリケーションにおいて、先進的な顧客との商談は引き続き活発
- “Solution SoC”ビジネスモデルを活用し、革新的な市場で必要となるカスタム(Bespoke) SoCを提供

Industrial / Physical AI

人間とロボットが対話するアプリケーションを含むPhysical AIの分野は、長期的に大きな成長機会

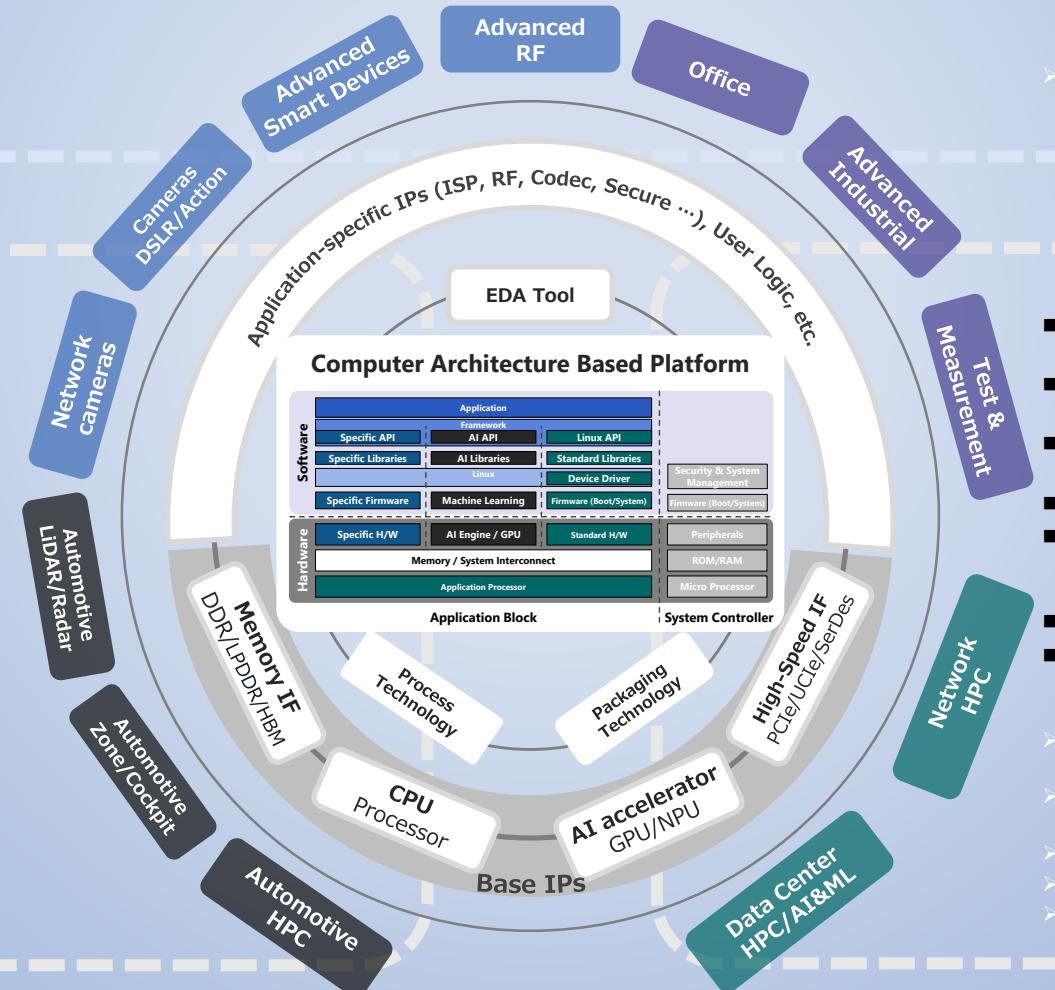
Industrial

- AIやネットワークの活用拡大により、産業用途で先端技術を使用した“Solution SoC”ビジネスモデルへの需要が拡大
- FA、計測機器やRF-CMOS技術を用いたカスタムSoCなどビジネスチャンスが拡大
- AIやCPUを強化し、アプリケーションIPや顧客の既存IPと統合した新たなSoCを開発する動き
- “Solution SoC”ビジネスモデルで、先端プロセスノードを適用し、また、RF-CMOSテクノロジーなどを組み込んだ“カスタム(Bespoke) SoC”を提供

Automotive

- AIが重要な役割を果たすことで大きな変革を迎えており、主な要件は、低消費電力、低遅延、および厳格な安全基準 (ASIL-CおよびASIL-D)
- ADAS／AD(先進運転支援システム／自動運転)のイノベーションが継続
- ゾーンアーキテクチャやセンシングSoCに加え、HPCの需要も旺盛
- 電力の最適化、高機能を実現する“Solution SoC”ビジネスモデルを採用する顧客が増加、分野を超えて様々なIPとプロセッサーの統合が必要
- 商談は引き続き活発
- 最先端なカスタム(Bespoke) SoCプロジェクトへの参画
- 7nm及び5nm 製品の量産は FY25/3及びFY26/3から開始
- 次世代製品のさらなる機会が期待される
- サービス指向の企業や新たなOEM企業から次世代製品の販売機会が増加

- “Solution SoC”ビジネスモデルで業界でのポジションを確立
- 最先端の3nmプロセスノードを適用
- 最先端技術への投資を継続
(Chiplet, 3D/5.5D, 高速SerDes, Co-Packaged Optics, 2nm/14Å)



Data Center & Networking

- データ処理規模が大きくパフォーマンスと効率を追求するカスタムSoCの主要ターゲット市場
- 電力の最適化、高機能を実現する“Solution SoC”ビジネスモデルを採用する顧客が増加、分野を超えて様々なIPとプロセッサーの統合が必要
- 生成AI需要の高まりによるデータセンター/ネットワークやクラウドサービス向けSoCの需要は成長拡大トレンド
- 2つの異なるアプローチ : scale-up and scale out
- ハイパースケーラー向けCPUプロジェクトが進行中
- 本プロジェクトをテコにCPU、AI分野での事業拡大を目指す
- 高速SerDesやCPO技術を使用する光データ伝送が要求される
- 北米で複数のAI SoCの商談を獲得し、開発を開始
- 先端分野への積極的な取り組みによる事業拡大を期待

- 世界でも、独自でユニークなCPU関連の開発経験と専門知識を有する“Solution SoC”ビジネスモデルでの事業拡大を目指す
- 最先端の技術・プロセスノードを使用した開発を進め、「Entire Design (全体設計)」能力を強化・活用
- 最先端分野でのIP企業との連携強化
- 北米及びグローバルでの研究開発体制と開発力の強化
- 最先端技術への投資を継続
(Chiplet, 3D/5.5D, 高速SerDes, Co-Packaged Optics, 2nm/14Å)

Smart Devices



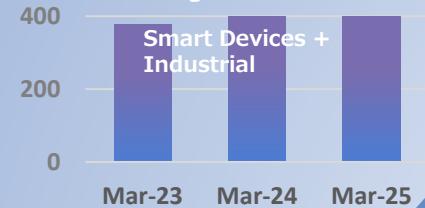
5/7/12nm
DSLR/Action



5/7nm
Network cameras
AR

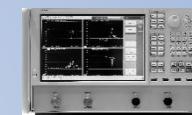


Design win balance



Industrial

5/7nm
Test & Measurement



28nm

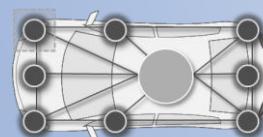
Printer



Automotive



16/22nm
LiDAR / Radar / Camera

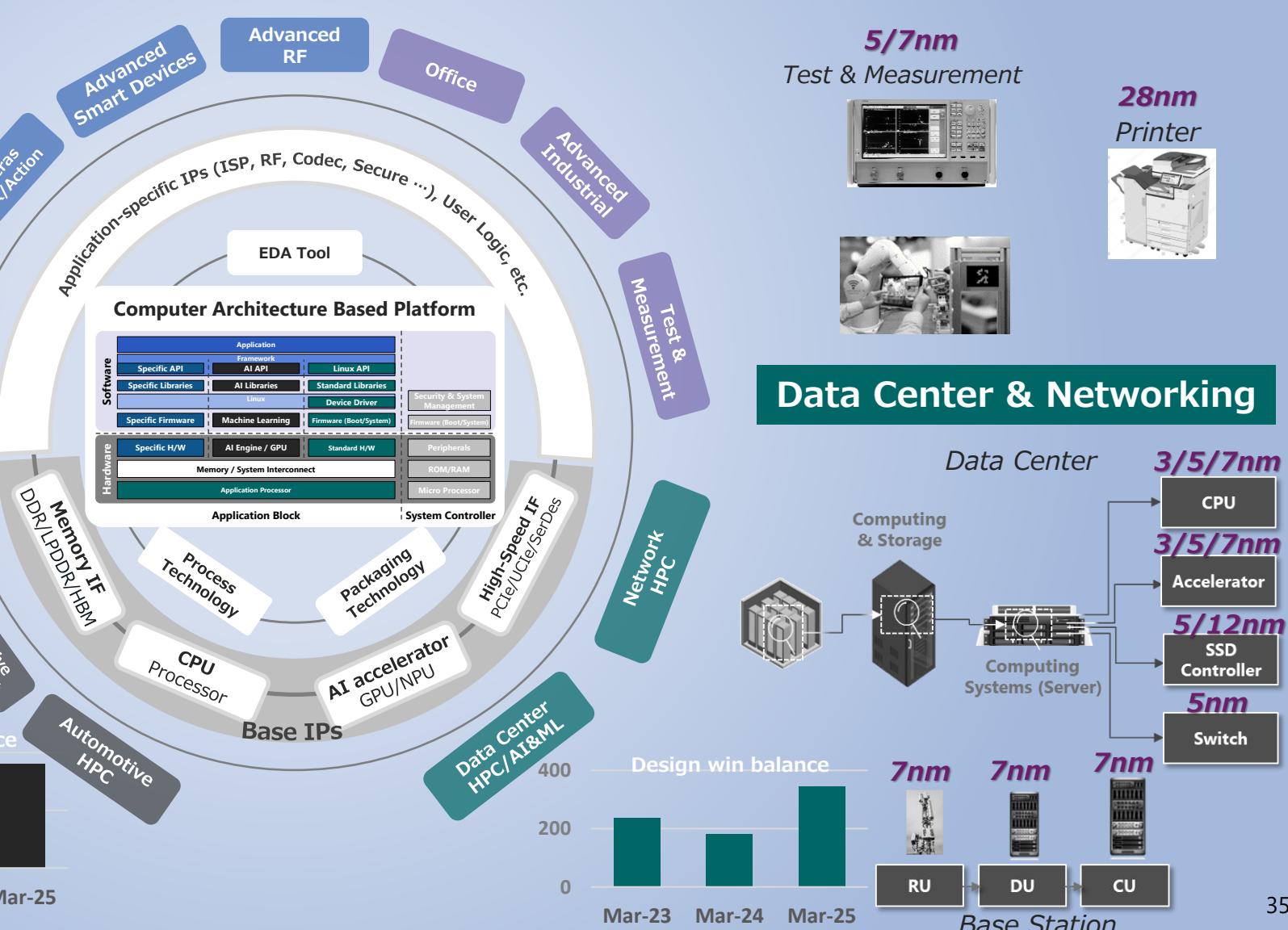
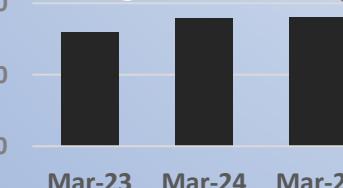


7/16/22nm
Zone Computing

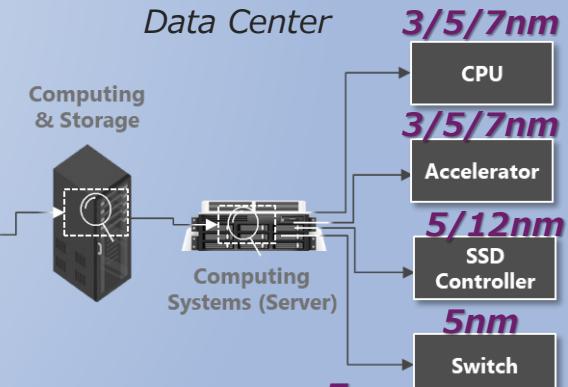


3/5nm
HP Computing

Design win balance



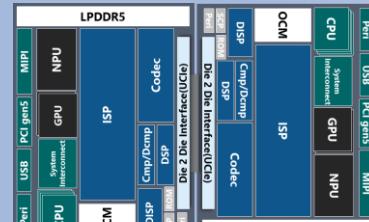
Data Center & Networking



- 主要アプリケーション間で、コンピューター・アーキテクチャー・ベースの似通ったシステム構成へ進む中、共通の開発プラットフォームを構築
- Chiplet、ヘテロジニアス・インテグレーション、サーマルマネジメント、信頼性など、設計の複雑化によるPPAの最適化の課題に対応

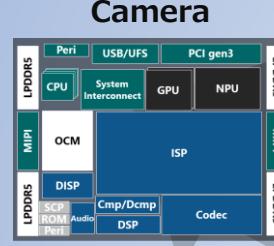
Smart Devices

Network Camera



Chiplet / Homogeneous

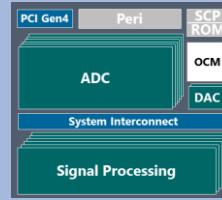
Camera



Chiplet / Homogeneous

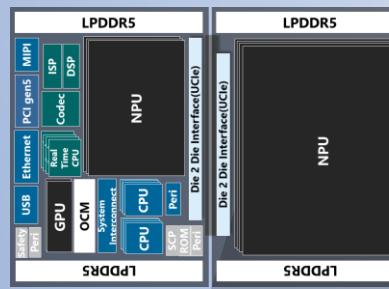
Automotive

LiDAR



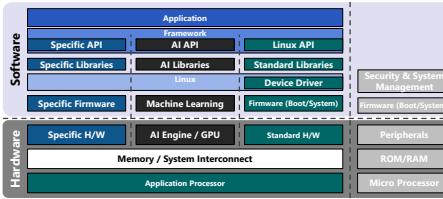
Chiplet / Homogeneous

ADAS



Chiplet / Heterogeneous

Computer Architecture Based Platform



Application-specific IPs (ISP, RF, Codec, Secure ...), User Logic, etc.

EDA Tool

Network cameras

Advanced Smart Devices
Cameras DSLR/Action

Advanced RF

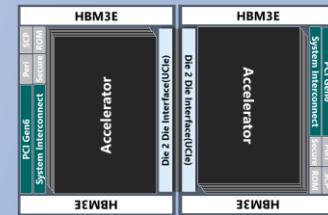
Office

Advanced Industrial

Measurement

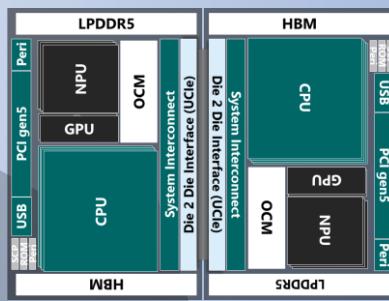
Data Center & Networking

AI Server Processor



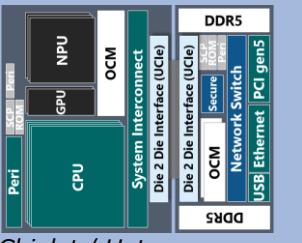
Chiplet / Homogeneous

Server Processor



Chiplet / Homogeneous

Server Processor



Chiplet / Heterogeneous

2025年4月～：グローバルリーディンググループとして大規模に拡大

グローバル組織体制の抜本的な改革

グローバル共同リード体制の構築

吉田COO（日本）/ R.Cheema CTO&EVP（米国）

- 真のグローバル体制を構築

“Entire design”能力の強化

- 大規模最先端開発プロジェクトを複数同時に進めることができる能力を強化
- 先端技術への積極的な投資
- 幅広い機能をカバーする高いスキルを持つエンジニアチームを配置（SoCアーキテクチャー、ソフトウェア、検証、テスト、パッケージ、サーマルマネジメントなど）

グローバルな競争力のある開発体制の構築

グローバル開発体制の構築

- 高いスキルを持つエンジニアをグローバルに採用
- 日本とその他地域（主に米国）のエンジニアチームを統合

グローバルプロジェクトマネジメント体制を強化

- 海外地域会社のプロジェクトマネージャーと日本の連携強化

グローバルなリソースマネジメント体制の構築

リソースマネジメント（アウトソーシング含む）

- インドに新拠点を開設、米国現地法人主導のもと、社内外リソースを運用・強化

Solution SoCビジネスモデルに沿った複数領域での
複数同時（並行）開発を可能とする体制の構築・強化



<新たな株式報酬制度の導入検討>
グローバルな技術・マネジメント人材の獲得・確保を目的とした株式報酬制度の導入を検討
当該制度に関連して交付する株式に充当する可能性も考慮し自己株式取得を実施

- 売上高：2026年度から再び本格的な成長路線へ進み10%台半ば(為替影響を除く実質で)の年平均成長率を目指す
- 営業利益率：売上拡大や開発競争力の強化とともに10%台半ばから後半を目指す

Medium-Term Targets

	2024年度 実績	2025年度 予想(10月時点)	Medium-Term Targets*
売上高成長率	1,885億円 (1,700億円) 1ドル152.6円 (130円)	1,900億円 1ドル138円	年平均成長率 10%台半ば
営業利益率 (営業利益)	13.3% (250億円)	5.3% (100億円)	10%台半ばから後半

* 為替影響を除いた実質での成長目標（1ドル130円を前提に作成しています。）

ご参考

中期事業目標(2022年9月公表)

	2020年度	2021年度	中期目標
売上高成長率	997億円	1,170億円	年平均成長率 10%台後半
営業利益率	1.6%	7.2%	10%台前半 ～半ば



実績

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
売上高	997	1,170	1,928	2,212	1,885
為替レート(USD/JPY)	106.1	112.4	135.5	144.6	152.6
営業利益率	1.6%	7.2%	11.3%	16.1%	13.3%

予想の取り扱いについては、P2免責事項をご参照ください。



以降、2025年4月決算説明会資料より再掲資料



- 2018年以降の事業変革を経て、年間“商談獲得金額”は2倍以上に増加
- 2022年度に引き続き2023年度も約3,000億円に達し、2024年度は約3,600億円に拡大



商談獲得金額は、事後的な事象に基づき更新はしておりません。事後的な事象には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止が含まれます。これまでに獲得した商談について将来的なキャンセルが発生する可能性は否定できません。また、事後的な事象による影響は、商談獲得残高に反映しています。

商談獲得残高は、その時点において存続している案件に関する商談獲得金額の累積値の、当該時点における当社の予測値です。そのため、商談獲得残高には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止など、事後的な事象が反映されています。例えば、FY19からFY24までの商談獲得金額の合計についておよそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまで、このようなキャンセルによる影響額は商談獲得後の単価上昇、数量増などの影響額でオフセットされほぼ同水準で推移してきましたが、FY24末時点では、北米オートモーティブ案件影響もあり、相当する商談獲得残高とこれまでの関連する売上の合計が、商談獲得金額の合計に対して数%の減少となっています。なお、上図については、1ドル120円で計算しています。商談獲得金額及び商談獲得残高に関する詳細はP3をご参照下さい。

1. 1ドル100円で試算した参考値です。

■ 大口商談の比率が増加

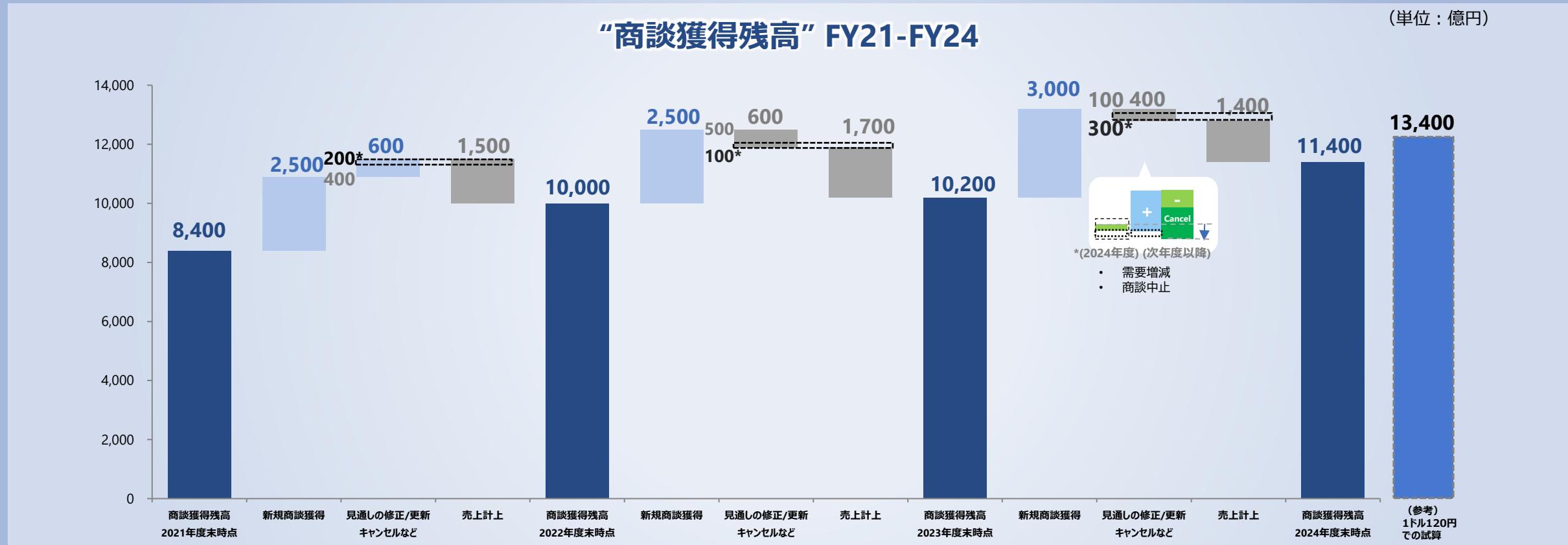


商談獲得金額は、事後的な事象に基づき更新はしておりません。事後的な事象には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止が含まれます。これまでに獲得した商談について将来的なキャンセルが発生する可能性は否定できません。また、事後的な事象による影響は、商談獲得残高に反映しています。

商談獲得残高は、その時点において存続している案件に関する商談獲得金額の累積値の、当該時点における当社の予測値です。そのため、商談獲得残高には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止など、事後的な事象が反映されています。例えば、FY19からFY24までの商談獲得金額の合計についておよそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまで、このようなキャンセルによる影響額は商談獲得後の単価上昇、数量増などの影響額でオフセットされほぼ同水準で推移してきましたが、FY24末時点では、北米オートモーティブ案件影響もあり、相当する商談獲得残高とこれまでの関連する売上の合計が、商談獲得金額の合計に対して数%の減少となっています。なお、上図については、1ドル120円で計算しています。商談獲得金額及び商談獲得残高に関する詳細はP3をご参照下さい。

1. 1ドル100円で試算した参考値です。

- 大口商談の獲得や獲得済商談の増加などで、商談キャンセルなどによる減少があったが、商談獲得残高は約10%、約1,000億円以上増加
- 現在の商談獲得残高の約60%が、今後4年間に売上計上されると期待



商談獲得金額⁷は、事後的な事象に基づき更新はしておりません。事後的な事象には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止が含まれます。これまでに獲得した商談について将来的なキャンセルが発生する可能性は否定できません。また、事後的な事象による影響は、商談獲得残高に反映しています。

商談獲得残高は、その時点において存続している案件に関する商談獲得金額の累積値の、当該時点における当社の予測値です。そのため、商談獲得残高には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止など、事後的な事象が反映されています。例えば、FY19からFY24までの商談獲得金額の合計についておよそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまで、このようなキャンセルによる影響額は商談獲得後の単価上昇、数量増などの影響額でオフセットされほぼ同水準で推移してきましたが、FY24末時点では、北米オートモーティブ案件影響もあり、相当する商談獲得残高とこれまでの関連する売上の合計が、商談獲得金額の合計に対して数%の減少となっています。なお、上図については、1ドル100円で計算しています。商談獲得金額及び商談獲得残高に関する詳細はP3をご参照下さい。

* [] は需要増減の当該年度中の売上増減を示しています。この中には次年度以降へのシフト分を含みます。

■ アプリケーション別について

- データセンター/ネットワーク分野での新規商談獲得により、データセンター/ネットワークの商談獲得残高の比率が増加
- 商談獲得残高の構成比は、オートモーティブ、データセンター/ネットワーク、それ以外のアプリケーションがそれぞれ全体の3分の1程度

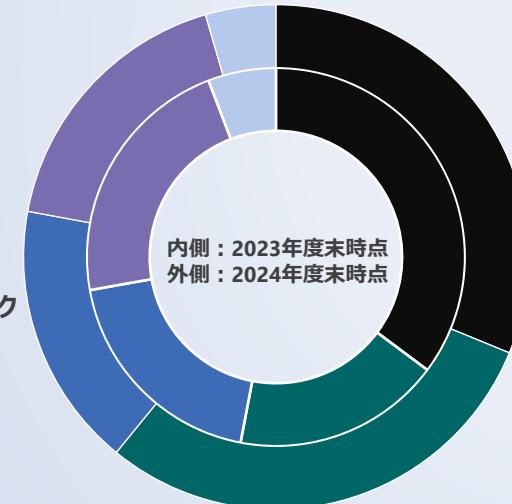
■ 地域別について

- 米国のシェアが若干増加し、米国、日本、その他（中国を含む）の各地域がそれぞれ全体の3分の1程度とバランスの取れた構成を保つ



商談獲得残高

12,000億円 (10,200² 億円) (2023年度末時点)
13,400億円 (11,400² 億円) (2024年度末時点)



- 米国
- 欧州
- 中国
- 中国除くアジア
- 日本

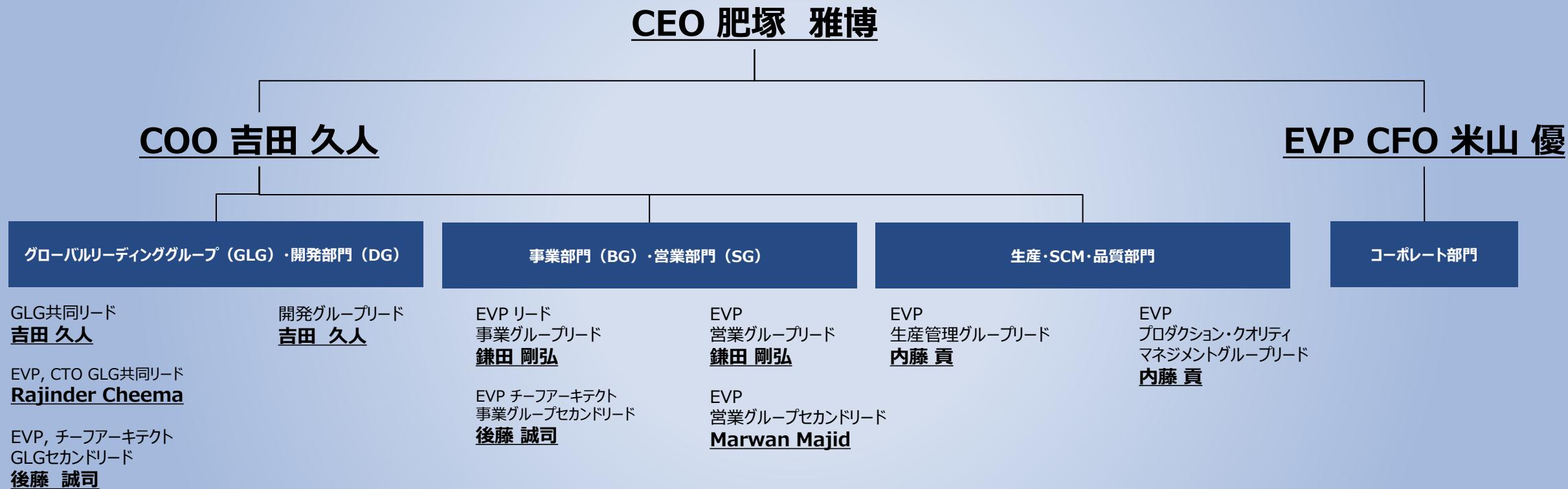


1. 商談獲得残高における地域別は弊社地域会社別ベースとなっています。

2. 1ドル100円で算出した値です。

新たな執行体制

2025年4月～：持続的な成長に向け新たな執行体制を構築



- グローバル技術戦略委員会は、CEO、COO、CTO、チーフアーキテクトで構成される
- なお、EVP(Executive Vice President)である斎藤正は 開発グループ 副グループ長、中島雅逸は事業グループ オートモーティブビジネスユニット副ビジネスユニット長、安藤慎一はコーポレート部門 財務経理担当とし、林豊は引き続き従来の業務を担当
- 本内容は2025年2月公開済

商談獲得金額から売上までのイメージ

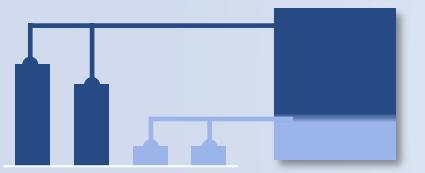
“商談獲得残高”とは

“商談獲得残高”とは

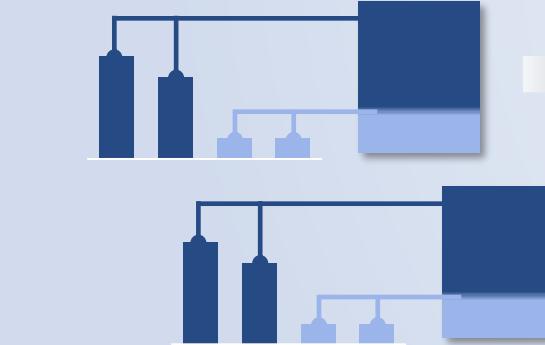
“商談獲得残高”は、ある時点までに獲得され存続している商談の“商談獲得金額”的累積値から見込まれる顧客需要に関する当社の予測を示している。“商談獲得残高”は商談を獲得した期間の末から残高確認時点までの進捗又は変化を反映したものである。“商談獲得残高”は将来のリスクを都度反映するよう、保守的な方法で定期的に見直される

“商談獲得金額”の累積値から見込まれる “商談獲得残高¹”

“商談獲得金額”



“商談獲得残高”



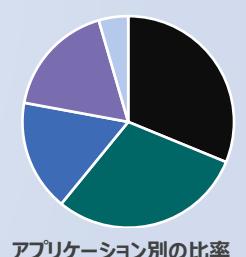
N-1年度末

“商談獲得残高”から売上までのイメージ²



N年度
売上高
N年度
末

“商談獲得残高”
(2024年度末時点)
約1.34兆円



商談獲得金額は、事後的な事象に基づき更新はしておりません。事後的な事象には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止が含まれます。これまでに獲得した商談について将来的なキャンセルが発生する可能性は否定できません。また、事後的な事象による影響は、商談獲得残高に反映しています。

商談獲得残高は、その時点において存続している案件に関する商談獲得金額の累積値の、当該時点における当社の予測値です。そのため、商談獲得残高には、(1)当該案件に係る実際の売上又は開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティの変更などの増減要因及び、(2)商談獲得後の案件の中止など、事後的な事象が反映されています。例えば、FY19からFY24までの商談獲得金額の合計についておよそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまでには、このようなキャンセルによる影響額は商談獲得後の単価上昇、数量増などの影響額でオフセットされほぼ同水準で推移してきましたが、FY24末時点では、北米オートモーティブ案件影響もあり、相当する商談獲得残高とこれまでの関連する売上の合計が、商談獲得金額の合計に対して数%の減少となっています。なお、上図については、1ドル120円で計算しています。商談獲得金額及び商談獲得残高に関する詳細はP3をご参照下さい。

説明目的の図となっています。

“商談獲得金額”とは

“商談獲得金額”は、獲得した商談から見込まれる将来の顧客需要に関する当社の予測を示している。

“商談獲得金額”はNRE由来のものと製品由来のものに分けられる。“商談獲得金額”は、プロジェクトが量産段階に進むと製品売上に貢献する見込み
なお、当社は“商談獲得金額”を例えば以下のように保守的に算出している

- 顧客に提示された売上高予想ではなく、当社予測による製品単価や将来の製品の販売数量などの一定の前提に基づいて個別の“商談獲得金額”を予測¹
- 想定為替レートは1ドル＝120円を使用

商談獲得から量産までの時間軸イメージ²

“商談獲得
金額”

0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目以降

★
商談獲得

設計開発

量産

製品売上

当社の営業利益の主な源泉

NRE売上
営業利益への貢献は限定的

売上高

研究開発費

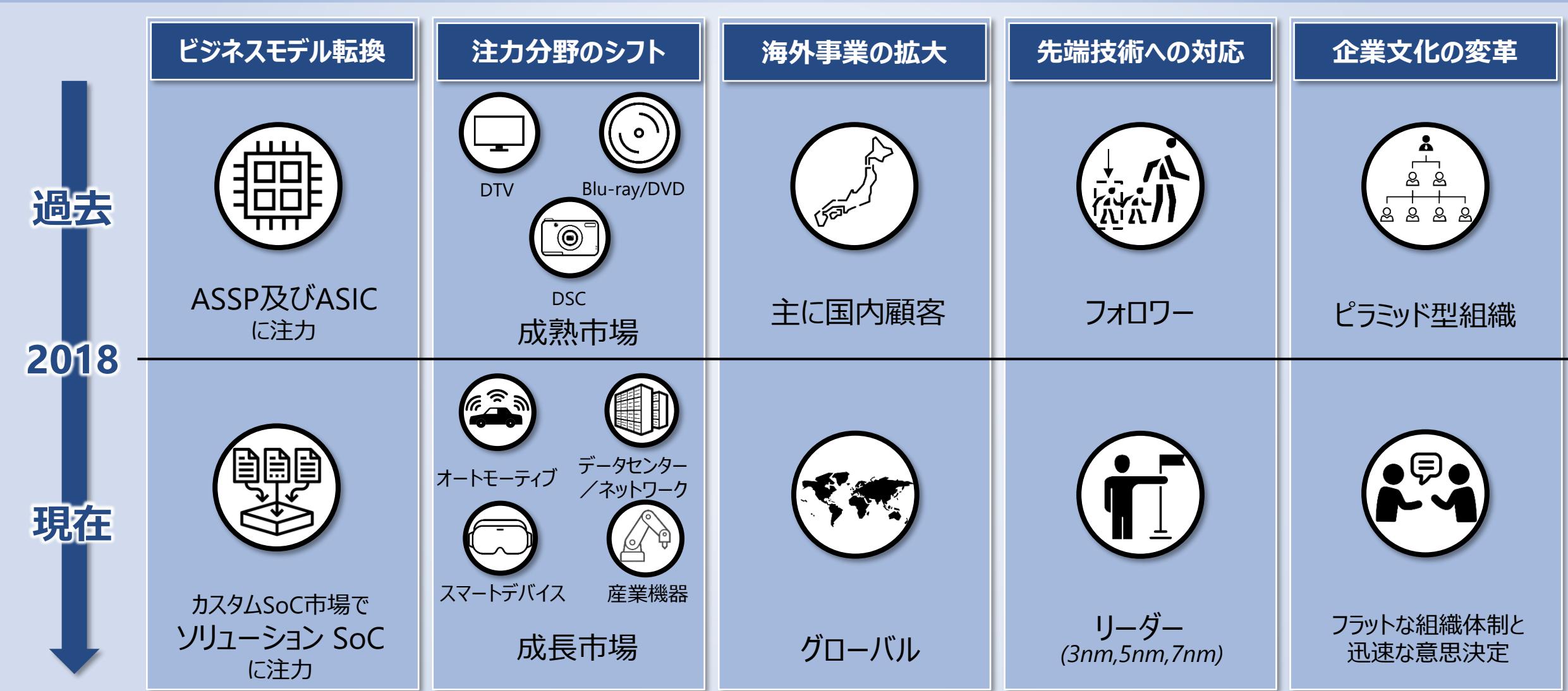
費用

売上原価

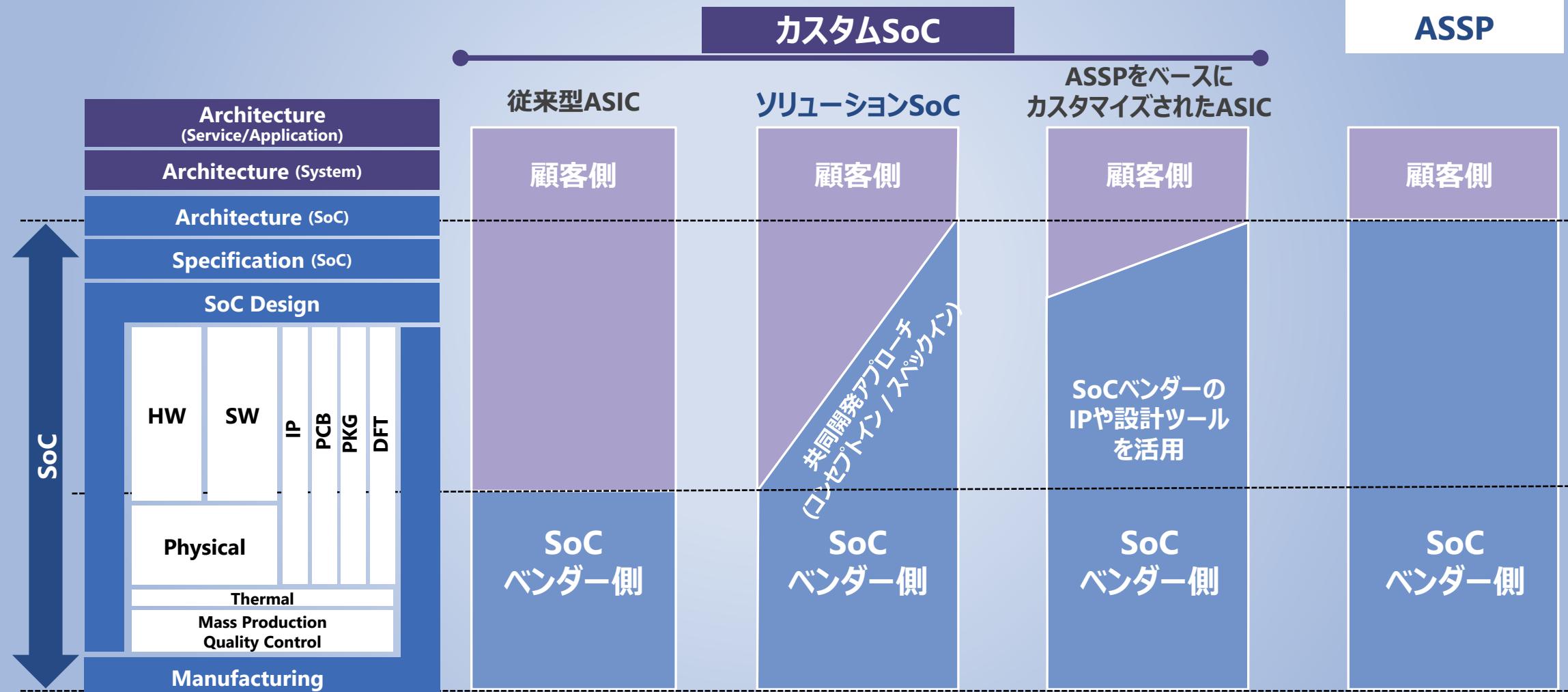
1. P.3をご参照下さい。

2. 説明目的の図であり、製品開発から量産までの実際のタイムラインは、製品や実際の顧客の需要によって大きく異なる場合もあります。

- 事業及び企業文化の変革を通じ、新しい独自のビジネスモデル“ソリューションSoC”で業界をリードするグローバルなカスタムSoCベンダーに転換



- 従来型ASICとソリューションSoCの主な違い：顧客とのインターフェース
- ソリューションSoCとASSPをベースにカスタマイズされたASICの主な違い：カスタマイズの幅



socionext™

The Solution SoC Company